

(11)Publication number:

2003-003047

(43) Date of publication of application: 08.01.2003

(51)Int.CI.

CO8L 65/00 C08J 5/18 CO8K CO8K CO8L 71/12 H01L 21/312

(21)Application number: 2001-192322

(71)Applicant: JSR CORP

(22)Date of filing:

26.06.2001

(72)Inventor: NISHIKAWA MICHINORI

SHINOHARA NOBUYASU

OKADA TAKASHI YAMADA KINJI

(54) FILM-FORMING COMPOSITION, METHOD FOR FORMING FILM AND ORGANIC FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a film-forming composition which provides a coating film exhibiting a relative dielectric constant of 2.5 or below and excellent in elasticity, low moisture absorption and crack resistance of the coating film as an interlayer insulating film material in semiconductor devices. SOLUTION: The film-forming composition comprises (A) an aromatic polyarylene and/or an aromatic polyarylene ether, (B) an organic solvent, and (C) a fullerene and/or a carbon nanotube.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-3047 〈P2003-3047A)

(43)公開日 平成15年1月8日(2003.1.8)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	デーマコート*(参考)		
C08L 65/00		C08L 65/00	4 F 0 7 1		
CO8J 5/18	CEZ	C08J 5/18	CEZ 4J002		
C 0 8 K 3/04		C 0 8 K 3/04	5 F 0 5 8		
5/00		5/00			
CO8L 71/12		COSL 71/12			
	審査請求	未請求 請求項の数6 OL	(全 24 頁) 最終頁に続く		
(21)出願番号	特顧2001-192322(P2001-192322)	(71)出顧人 000004178			
	·	ジェイエスア	ール株式会社		
(22)出願日	平成13年6月26日(2001.6.26)	東京都中央区築地2丁目11番24号			
		(72)発明者 西川 通則			
		東京都中央区	築地二丁目11番24号ジェイエ		
		スアール株式			
		(72)発明者 篠原 宜康			
•		東京都中央区	築地二丁目11番24号ジェイエ		
		スアール株式	会社内		
		(72)発明者 岡田 敬			
		東京都中央区	築地二丁目11番24号ジェイエ		
		スアール株式			
			最終頁に続く		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

(54) 【発明の名称】 膜形成用組成物、膜の形成方法および有機膜

(57)【要約】

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、2.5以下の比誘電率を示し、かつ塗膜弾性率、低吸湿性及び耐クラック性に優れる塗膜が得られる膜形成用組成物を得る。

【解決手段】 (A) 芳香族ポリアリーレンおよび芳香族ポリアリーレンエーテルもしくはいずれか一方、

(B) 有機溶剤ならびに(C) フラーレンおよびカーボンナノチューブもしくはいずれか一方を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 芳香族ポリアリーレンおよび芳香族ポリアリーレンエーテルもしくはいずれか一方、

(B) 有機溶剤ならびに(C) フラーレンおよびカーボンナノチューブもしくはいずれか一方を含有することを 特徴とする膜形成用組成物。

【請求項2】 (A) 成分に対する(C) 成分の使用割*

*合が、(A)成分100重量部に対して(C)成分5~ 50重量部であることを特徴とする請求項1記載の膜形 成用組成物。

【請求項3】 (A) 成分が下記一般式(1)~(3) の群から選ばれる少なくとも1種の重合体であることを特徴とする請求項1~2記載の膜形成用組成物。

【化1】一般式(1)

【化2】一般式(2)

【化3】一般式(3)

 $[R^7 \sim R^{11}$ はそれぞれ独立して炭素数 $1 \sim 20$ の炭化 水素基、シアノ基、ニトロ基、炭素数1~20のアルコ キシル基、アリール基、またはハロゲン原子、Xは一C QQ'ー(ここでQ、Q'は同一であっても異なってい てもよく、ハロゲン化アルキル基、アルキル基、水素原 子、ハロゲン原子またはアリール基を示す) に示す基 およびフルオレニレン基からなる群から選ばれる少なく とも1種であり、Yは-O-、-CO-、-COO-、 -CONH-、-S-、-SO2-およびフェニレン基 30 の群から選ばれた少なくとも1種であり、aは0または 1を示し、b~fは0~4の整数を示し、gは5~10 0モル%、hは0~95モル%、iは0~95モル% (ただし、g+h+i=100モル%)、jは0~10 0モル%、kは $0\sim100$ モル% (ただし、j+k=100モル%)。AおよびBはそれぞれ独立に下記一般式 (4)~(6)で表される2価の芳香族基からなる群か ら選ばれる少なくとも1種の基である。]

【化4】一般式(4)

【化5】一般式(5)

【化6】一般式(6)

(式中、R¹²、R¹³、R¹⁸及びR¹⁹は、独立に 単結合、-O-、-CO-、-CH2-、-COO-、 -CONH-、-S-、-SO2-、フェニレン基、イ ソプロピリデン基、ヘキサフルオロイソプロピリデン 基、ジフェニルメチリデン基又はフルオレニレン基を表 わし、R¹⁴~R¹⁶、R¹⁷及びR²⁰~R²²は独 立に炭素原子数1~20の炭化水素基、シアノ基、ニト 口基、炭素原子数1~20のアルコキシル基又はアリー ル基を表わし、1およびqは独立に0~3の整数を示 し、m~p及びr~tは独立に0~4の整数を示す。) 【請求項4】 (B) 成分がシクロヘキサノン、 y -ブチロラクトン、シクロペンタノン、メシチレン、Nー メチルー2ーピロリドン、N、N-ジメチルホルムアミ ド、N, Nージメチルアセトアミドの群から選ばれる少 なくとも1種であることを特徴とする請求項1~3記載 の膜形成用組成物。

【請求項5】 請求項1項記載の膜形成用組成物を基40 板に塗布し、加熱することを特徴とする膜の形成方法。 【請求項6】 請求項5記載の膜の形成方法によって得られる有機膜。

【発明の詳細な説明】本発明は、膜形成用組成物に関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、2.5以下の比誘電率を示し、かつ塗膜弾性率、低吸湿性及び耐クラック性に優れる塗膜が得られる膜形成用組成物に関する。

[0001]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 50 膜として、CVD法などの真空プロセスで形成されたシ

リカ(Si〇2)膜が多用されている。そして、近年、より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、SOG(Spin on Glass)膜と呼ばれるテトラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする塗布型無機絶縁膜やポリアリーレンエーテルなどの塗布型有機絶縁膜も使用されるようになっている。特に半導体素子などのさらなる高集積化や多層化に伴い、より優れた導体間の電気絶縁性が要求されており、したがって、より低比誘電率、好ましくは2.5以下層間絶縁膜材料が求められるようになっている。

【0002】低比誘電率の材料としては、アンモニアの存在下にアルコキシシランを縮合して得られる微粒子とアルコキシシランの塩基性部分加水分解物との混合物からなる組成物(特開平5-263045、同5-315319)や、ポリアルコキシシランの塩基性加水分解物をアンモニアの存在下縮合することにより得られた塗布液(特開平11-340219、同11-340220)が提案されているが、これらの方法で得られる材料は、反応の生成物の性質が安定せず、2.5以下の低比誘電率が得られ難く、塗膜弾性率、低吸湿性及び耐クラ20ック性に劣るなど、工業的生産には不向きであった。【0003】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しく* *は、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、2.5 以下の比誘電率を示し、かつ塗膜弾性率、低吸湿性及び 耐クラック性に優れる塗膜が得られる膜形成用組成物を 提供することを目的とする。

【0004】本発明は、(A) 芳香族ポリアリーレンおよび芳香族ポリアリーレンエーテルもしくはいずれか一方、(B) 有機溶剤ならびに(C) フラーレンおよびカーボンナノチューブもしくはいずれか一方を含有することを特徴とする膜形成用組成物ならびに該膜形成用組成物を基板に塗布し、加熱することを特徴とする膜の形成方法に関する。次に、本発明は、上記膜の形成方法によって得られる有機膜に関する。

[0005]

【発明の実施の形態】(A)成分

本発明の(A) 成分は、芳香族ポリアリーレンおよび芳香族ポリアリーレンエーテルもしくはいずれか一方であり、下記一般式(1) で表される繰り返し構造単位を有する重合体(以下「重合体(1)」ともいう)、下記一般式(2)で表される繰り返し構造単位を有する重合体(以下「重合体(2)」ともいう)、および下記一般式(3)で表される繰り返し構造単位を有する重合体(以下「重合体(3)」ともいう)が好ましい。

【化7】一般式(1)

$$\begin{array}{c|c} (R^7)_b & (R^8)_c & (R^9)_d & (R^{10})_e & (R^{11})_f \\ \hline \\ (R^7)_b & (R^8)_c & (R^8)_d & (R^8)_d & (R^8)_c & (R^8)_d \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_d & (R^8)_d & (R^8)_d & (R^8)_d \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_d & (R^8)_d & (R^8)_d & (R^8)_d \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_d & (R^8)_d & (R^8)_d & (R^8)_d \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_d & (R^8)_d & (R^8)_d & (R^8)_d \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_d & (R^8)_d & (R^8)_d \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_d & (R^8)_d & (R^8)_d \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_d \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c & (R^8)_c \\ \hline \\ (R^8)_b & (R^8)_c & (R^8)_c$$

【化8】一般式(2)

3

【化9】一般式(3)

【0006】 $[R^7 \sim R^{11}$ はそれぞれ独立して炭素数 $1 \sim 20$ の炭化水素基、シアノ基、二トロ基、炭素数 $1 \sim 40$ 20のアルコキシル基、アリール基、またはハロゲン原子、Xは-CQQ'-(22でQ、Q'は同一であっても異なっていてもよく、ハロゲン化アルキル基、アルキル基、水素原子、ハロゲン原子またはアリール基を示す)に示す基、およびフルオレニレン基からなる群から選ばれる少なくとも1種であり、Yは-O-、-CO-、-COO-、-CONH-、-S-、-SO2-およびフェニレン基の群から選ばれた少なくとも1種であり、aは0または1を示し、b~fは0~4の整数を示し、gは5~100モル%、hは0~95モル%、iは50

 $0\sim95$ モル%(ただし、g+h+i=100モル%)、jは $0\sim100$ モル%、kは $0\sim100$ モル%(ただし、j+k=100モル%)。AおよびBはそれぞれ独立に下記一般式(4)~(6)で表される2価の芳香族基からなる群から選ばれる少なくとも1種の2価の芳香族基である。

【化10】一般式(4)

【化11】一般式(5)



【化12】一般式(6)

$$(R^{20})_t$$
 $(R^{21})_s$ $(R^{22})_t$

(式中、R¹²、R¹³、R¹⁸及びR¹⁹は、独立に 10 単結合、一〇一、一〇〇一、一〇H2一、一〇〇〇一、 -CONH-、-S-、-SO2-、フェニレン基、イ ソプロピリデン基、ヘキサフルオロイソプロピリデン 基、ジフェニルメチリデン基又はフルオレニレン基を表 わし、R14~R16、R17及びR20~R22は独 立に炭素原子数1~20の炭化水素基、シアノ基、ニト 口基、炭素原子数1~20のアルコキシル基又はアリー ル基を表わし、1およびqは独立に0~3の整数を示 し、 $m \sim p$ 及び $r \sim t$ は独立に $0 \sim 4$ の整数を示す。) 【0007】重合体(1);式(1)で表される重合体 20 は、例えば、下記一般式(7)に示す化合物を含むモノ マーを遷移金属化合物を含む触媒系の存在下に重合する ことによって製造することができる。

[0008]

【化13】一般式(7)

(式中、R7 , R8 はそれぞれ独立して炭素数1~ 30 一般式 (11) 20の炭化水素基、シアノ基、ニトロ基、炭素数1~2 0のアルコキシル基、アリール基またはハロゲン原子、 Xは-CQQ'-(ここで、Q,Q'は同一であっても 異なっていてもよく、ハロゲン化アルキル基、アルキル 基、水素原子、ハロゲン原子またはアリール基を示す) に示す基、およびフルオレニレン基からなる群から選ば れる少なくとも1種であり、b, cは0~4の整数を示 し、乙はアルキル基、ハロゲン化アルキル基またはアリ ール基を示す。)

【0009】上記一般式式(7)中のXを構成するQ. Q' のうち、アルキル基としては、メチル基、エチル 基 i-プロピル基、n-プロピル基、ブチル基、ペン チル基、ヘキシル基など;ハロゲン化アルキル基として は、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基な ど;アリールアルキル基としては、ベンジル基、ジフェ ニルメチル基など;アリール基としては、フェニル基 ピフェニル基、トリル基、ペンタフルオロフェニル基な どを挙げることができる。

【0010】 また、上記式 (7) 中の、-OSO2 Z を構成する乙としては、アルキル基として、メチル基

エチル基など; ハロゲン化アルキル基としては、トリフ ルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基など; アリー ル基としては、フェニル基、ビフェニル基、p-トリル 基、pーペンタフルオロフェニル基などを挙げることが できる。上記一般式(7)中のXとしては、下記一般式 (8)~(13)に示す2価の基が好ましい。これらの うちでは、一般式(13)に示すフルオレニレン基がさ らに好ましい。

【0011】一般式(8)

【化14】

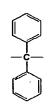
一般式(9)

【化15】

一般式 (10) 【化16】

【化17】

一般式 (12) 【化18】



一般式(13) (化19)

50

7



【0012】上記一般式(7)に示す化合物(モノマ 一) の具体例としては、例えば、2, 2-ビス(4-メ チルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパ ン、ビス(4ーメチルスルフォニロキシフェニル)メタ ン、ビス(4 -メチルスルフォニロキシフェニル)ジフ ェニルメタン、2,2ービス(4ーメチルスルフォニロ キシー3-メチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、 2, 2ービス(4ーメチルスルフォニロキシー3ープロ ペニルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビ ス(4-メチルスルフォニロキシ-3,5-ジメチルフ エニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2ービス(4-メチルスルフォニロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-メチルフェニ ル)プロパン、2,2-ビス(4-メチルスルフォニロ キシー3ープロペニルフェニル)プロパン、2,2ービ ス(4-メチルスルフォニロキシー3,5-ジメチルフ エニル)プロパン、2,2-ビス(4-メチルスルフォ ニロキシー3ーフルオロフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3,5-ジフルオ ロフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-トリフルオ ロメチルスルフォニロキシフェニル)プロパン、2,2 ービス(4 ートリフルオロメチルスルフォニロキシー3 ープロペニルフェニル)プロパン、2,2ービス(4-フェニルスルフォニロキシフェニル)プロパン、2,2 ービス(4ーフェニルスルフォニロキシー3ーメチルフ エニル)プロパン、2,2-ビス(4-フェニルスルフ オニロキシー3ープロペニルフェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシー3,5-ジ メチルフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-フェニ ルスルフォニロキシー3-フルオロフェニル) ジフェニ ルメタン、2, 2-ビス(p-トリルスルフォニロキシ フェニル)プロパン、2,2-ビス(p-トリルスルフ オニロキシー3ーメチルフェニル)プロパン、2,2-ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3-プロペニルフ エニル)プロパン、2,2-ビス(p-トリルスルフォ ニロキシー3, 5ージメチルフェニル)プロパン、2, 2-ビス (p-トリルスルフォニロキシー3-メチルフ エニル)プロパン、2,2-ビス(p-トリルスルフォ ニロキシー3,5ージメチルフェニル)プロパン、2, 2-ビス (p-トリルスルフォニロキシー3-プロペニ ルフェニル) プロパン、ビス (p-トリルスルフォニロ キシー3-フルオロフェニル)プロパン、ビス (p-ト リルスルフォニロキシー3,5ージフルオロフェニル) プロパン9, 9ービス(4ーメチルスルフォニロキシフ エニル)フルオレン、9,9-ビス(4-メチルスルフ オニロキシー3ーメチルフェニル)フルオレン、9,9

ービス(4ーメチルスルフォニロキシー3,5ージメチ ルフェニル)フルオレン、9,9-ビス(4-メチルス ルフォニロキシー3ープロペニルフェニル) フルオレ ン、9、9ービス(4ーメチルスルフォニロキシー3ー フェニルフェニル) フルオレン、ビス (4-メチルスル フォニロキシー3ーメチルフェニル) ジフェニルメタ ン、ビス(4ーメチルスルフォニロキシー3,5ージメ チルフェニル) ジフェニルメタン、ビス(4-メチルス ルフォニロキシー3ープロペニルフェニル) ジフェニル メタン、ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-フル オロフェニル) ジフェニルメタン、ビス (4-メチルス ルフォニロキシー3,5ージフルオロフェニル)ジフェ ニルメタン、9、9ービス(4ーメチルスルフォニロキ シー3-フルオロフェニル) フルオレン、9,9-ビス (4-メチルスルフォニロキシ-3, 5-ジフルオロフ エニル) フルオレン、ビス(4-メチルスルフォニロキ シフェニル) メタン、ビス(4-メチルスルフォニロキ シー3-メチルフェニル) メタン、ビス(4-メチルス ルフォニロキシー3, 5-ジメチルフェニル)メタン、 ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-プロペニルフ エニル) メタン、ビス(4-メチルスルフォニロキシフ エニル)トリフルオロメチルフェニルメタン、ビス(4 ーメチルスルフォニロキシフェニル) フェニルメタン、 2, 2-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキ シフェニル) ヘキサフルオロプロパン、ビス (4-トリ フルオロメチルスルフォニロキシフェニル) メタン、ビ ス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニ ル) ジフェニルメタン、2, 2-ビス(4-トリフルオ ロメチルスルフォニロキシー3-メチルフェニル) ヘキ サフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-トリフルオロ メチルスルフォニロキシー3ープロペニルフェニル)へ キサフルオロプロパン、2,2-ビス(4-トリフルオ ロメチルスルフォニロキシー3,5-ジメチルフェニ ル) ヘキサフルオロプロパン、9,9-ビス(4-トリ フルオロメチルスルフォニロキシフェニル) フルオレ ン、9,9ービス(4ートリフルオロメチルスルフォニ ロキシー3-メチルフェニル) フルオレン、9,9-ビ ス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3,5 ージメチルフェニル)フルオレン、9,9ービス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3ープロペニル フェニル) フルオレン、9,9-ビス(4-トリフルオ ロメチルスルフォニロキシー3-フェニルフェニル) フ ルオレン、ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロ キシー3ーメチルフェニル)ジフェニルメタン、ビス (4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3,5-ジメチルフェニル) ジフェニルメタン、ビス (4-トリ フルオロメチルスルフォニロキシー3ープロペニルフェ ニル) ジフェニルメタン、ビス(4 - トリフルオロメチ ルスルフォニロキシー3ーフルオロフェニル) ジフェニ 50 ルメタン、ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロ

キシー3,5-ジフルオロフェニル)ジフェニルメタ ン、9、9ービス(4ートリフルオロメチルスルフォニ ロキシー3ーフルオロフェニル) フルオレン、9,9-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3. 5-ジフルオロフェニル)フルオレン、ビス(4-トリ フルオロメチルスルフォニロキシフェニル) メタン、ビ ス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3-メ チルフェニル) メタン、ビス(4 - トリフルオロメチル スルフォニロキシー3,5ージメチルフェニル)メタ ン、ビス(4 - トリフルオロメチルスルフォニロキシー 10 3-プロペニルフェニル) メタン、ビス (4-トリフル オロメチルスルフォニロキシフェニル) トリフルオロメ チルフェニルメタン、ビス(4-トリフルオロメチルス ルフォニロキシフェニル)、2,2-ビス(4-フェニ ルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパ ン、ビス(4-フェニルスルフォニロキシフェニル)メ タン、ビス(4-フェニルスルフォニロキシフェニル) ジフェニルメタン、2,2-ビス(4-フェニルスルフ オニロキシー3ーメチルフェニル) ヘキサフルオロプロ パン、2,2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシー 3-プロペニルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、 $2, 2- \forall \lambda (4-7) = 2, 2- \forall \lambda (4-7) = 2, 5$ ージメチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、9,9 ービス(4 ーフェニルスルフォニロキシフェニル)フル オレン、9,9ービス(4ーフェニルスルフォニロキシ -3-メチルフェニル)フルオレン、9,9-ビス(4 ーフェニルスルフォニロキシー3,5ージメチルフェニ ル) フルオレン、9, 9-ビス(4-フェニルスルフォ ニロキシー3ープロペニルフェニル)フルオレン、9, 9-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-フェニ ルフェニル) フルオレン、ビス(4-フェニルスルフォ ニロキシー3ーメチルフェニル) ジフェニルメタン、ビ ス(4-フェニルスルフォニロキシー3,5-ジメチル フェニル) ジフェニルメタン、ビス (4-フェニルスル フォニロキシー3ープロペニルフェニル) ジフェニルメ タン、ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-フル オロフェニル) ジフェニルメタン、ビス (4ーフェニル スルフォニロキシー3,5ージフルオロフェニル)ジフ エニルメタン、9,9ービス(4-フェニルスルフォニ ロキシー3ーフルオロフェニル)フルオレン、9,9-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3,5-ジフル オロフェニル) フルオレン、ビス (4-フェニルスルフ オニロキシフェニル) メタン、ビス (4-フェニルスル フォニロキシー3ーメチルフェニル) メタン、ビス (4 ーフェニルスルフォニロキシー3,5ージメチルフェニ ル) メタン、ビス(4-フェニルスルフォニロキシー3 ープロペニルフェニル)メタン、ビス(4 ーフェニルス ルフォニロキシフェニル) トリフルオロメチルフェニル メタン、ビス(4 - フェニルスルフォニロキシフェニ

オニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン、ビス (p-トリルスルフォニロキシフェニル) メタン、ビス (p-トリルスルフォニロキシフェニル) ジフェニルメ タン、2, 2-ビス(p-トリルスルフォニロキシー3 ーメチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス (p-トリルスルフォニロキシー3-プロペニルフ エニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス (p-トリルスルフォニロキシー3,5-ジメチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、9, 9-ビス (p-トリルス ルフォニロキシフェニル) フルオレン、9,9ービス (p-トリルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル) フルオレン、9,9-ビス(p-トリルスルフォニロキ シー3,5ージメチルフェニル)フルオレン、9,9-ビス (p-トリルスルフォニロキシー3ープロペニルフ エニル)フルオレン、9,9-ビス(p-トリルスルフ オニロキシー3-フェニルフェニル) フルオレン、ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル) ジフェニルメタン、ビス(p-トリルスルフォニロキシ -3,5-ジメチルフェニル)ジフェニルメタン、ビス (p-トリルスルフォニロキシー3-プロペニルフェニ ル) ジフェニルメタン、ビス (p-トリルスルフォニロ キシー3-フルオロフェニル) ジフェニルメタン、ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3, 5-ジフルオロフ ェニル) ジフェニルメタン、9,9-ビス (p-トリル スルフォニロキシー3ーフルオロフェニル) フルオレ ン、9, 9-ビス(p-トリルスルフォニロキシー3. 5-ジフルオロフェニル) フルオレン、ビス (p-トリ ルスルフォニロキシフェニル) メタン、ビス (p-トリ ルスルフォニロキシー3ーメチルフェニル)メタン、ビ ス(p-トリルスルフォニロキシー3, 5-ジメチルフ ェニル) メタン、ビス (p-トリルスルフォニロキシー 3-プロペニルフェニル) メタン、ビス (p-トリルス ルフォニロキシフェニル) トリフルオロメチルフェニル メタン、ビス (p-トリルスルフォニロキシフェニル) フェニルメタンなどを挙げることができる。本発明にお いては、上記一般式(7)に示す化合物を2種以上共重

【0013】上記一般式(7)に示す化合物は、例えば、下記の製法によって合成することができる。すなわち、ビスフェノール化合物 [例えば、2,2ービス(4ービドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン] およびビスフェノール化合物の2当量以上の塩基を溶媒に溶かす。このとき、ピリジンなどを溶媒として用いて、溶媒と塩基との両方の役割を兼用させてもよい。また、必要に応じて、4ージメチルアミノピリジンなどの触媒を加えてもよい。

合することもできる。

ープロペニルフェニル)メタン、ビス(4 −フェニルス 【0014】次いで、スルフォン酸クロライド(無水ルフォニロキシフェニル)トリフルオロメチルフェニル 物)(例えば、メタンスルフォン酸クロライド)を15 メタン、ビス(4 −フェニルスルフォニロキシフェニ ℃以下に保持しながら、5~60分かけて乾燥窒素気流ル)フェニルメタン、2,2−ビス(p−トリルスルフ 50 下に滴下する。その後、その温度で0~60分攪拌した

のち、室温に戻し、0~24時間攪拌し、懸濁液を作成 する。得られた懸濁液を3~20倍量の氷水に再沈殿さ せ、その沈殿を回収し、再結晶などの操作を繰り返し て、結晶としてビススルフォネート化合物を得ることが

【0015】あるいは、まず、ビスフェノール化合物 〔例えば、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)へ キサフルオロプロパン〕を水酸化ナトリウム水溶液など の2当量のアルカリ水溶液に溶かす。その一方、スルフ オン酸クロライド(無水物)(例えば、メタンスルフォ ン酸クロライド)をトルエン、クロロホルムなどの有機 溶媒に溶かす。次いで、これらに必要に応じてアセチル トリメチルアンモニウムクロライドなどの相間移動触媒 を加えたのち、激しく撹拌する。その後、反応して得ら れた有機層を精製することによっても、目的のビススル フォネート化合物を得ることができる。

【0016】本発明においては、上記一般式(7)に示 す化合物の少なくとも1種と、下記一般式(14)~ (15) に示す化合物からなる群から選ばれる少なくと も1種とを共重合させてもよい。

【0017】一般式(14) 【化20】

$$(R^{9})_{d}$$
 $(R^{10})_{e}$ $(R^{12})_{a}$ $(R^{13})_{e}$

【0018】〔一般式 (14) 中、R9 ~R10はそ

れぞれ独立して炭素数1~20の炭化水素基、シアノ 基、ニトロ基、炭素数1~20のアルコキシル基、アリ ール基またはハロゲン原子、R12~R13は、-OS 30 O2 Z (ここで、Zはアルキル基、ハロゲン化アルキ ル基またはアリール基を示す。)、塩素原子、臭素原子 または沃素原子を示し、Yは-O-、-CO-、-CO O-、-CONH-、-S-、-SO2 -およびフェ ニレン基の群から選ばれた少なくとも1種であり、aは Oまたは1を示し、d, eは0~4の整数を示す。] 【0019】 R9 ~ R10のうち、ハロゲン原子とし ては、フッ素原子など、1価の有機基としては、アルキ ル基として、メチル基、エチル基など、ハロゲン化アル キル基として、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロ 40 エチル基など、アリル基として、プロペニル基など、ア リール基として、フェニル基、ペンタフルオロフェニル 基などを挙げることができる。また、-OSO2 Zを 構成する乙としては、アルキル基として、メチル基、エ チル基など、ハロゲン化アルキル基として、トリフルオ ロメチル基など、アリール基として、フェニル基、pー トリル基、pーフルオロフェニル基などを挙げることが

【0020】上記一般式(14)に示す化合物として

ェニル、4,4′ージメチルスルフォニロキシー3, 3' -ジプロペニルビフェニル、4, 4' -ジブロモビ フェニル、4, 4' -ジヨードビフェニル、4, 4' -ジメチルスルフォニロキシー3,3'ージメチルビフェ ニル、4,4'ージメチルスルフォニロキシー3,3' ージフルオロビフェニル、4,4'ージメチルスルフォ ニロキシー3, 3', 5, 5'ーテトラフルオロビフェ ニル、4,4'ージブロモオクタフルオロビフェニル、 4, 4-メチルスルフォニロキシオクタフルオロビフェ ニル、3, 3' - ジアリル-4, 4' - ビス (4 - フルオロベンゼンスルフォニロキシ) ビフェニル、4,4' ージクロロー2, 2′ートリフルオロメチルビフェニ ル、4、4′ージブロモー2、2′ートリフルオロメチ ルビフェニル、4,4'ージヨードー2,2'ートリフ ルオロメチルビフェニル、ビス (4-クロロフェニル) スルフォン、4, 4' -ジクロロベンゾフェノン、2, 4-ジクロロベンゾフェノンなどを挙げることができ る。上記一般式(14)に示す化合物は、1種単独で、 または2種以上を組み合わせて用いることができる。 【0021】一般式(15)

【化21】

【0022】 (一般式 (15) 中、R11は、炭素数1 ~20の炭化水素基、シアノ基、ニトロ基、炭素数1~ 20のアルコキシル基、アリール基またはハロゲン原 子、R14~R15は、-OSO2 Z (ここで、Zは アルキル基、ハロゲン化アルキル基またはアリール基を 示す。)、塩素原子、臭素原子または沃素原子を示し、 f は0~4の整数を示す。〕

【0023】R11のうち、ハロゲン原子としては、フ ッ素原子など、1価の有機基としては、アルキル基とし て、メチル基、エチル基など、ハロゲン化アルキル基と して、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基 など、アリル基として、プロペニル基など、アリール基 として、フェニル基、ペンタフルオロフェニル基などを 挙げることができる。また、-OSO2 Zを構成する 乙としては、アルキル基として、メチル基、エチル基な ど、ハロゲン化アルキル基として、トリフルオロメチル 基など、アリール基として、フェニル基、pートリル 基、p-フルオロフェニル基などを挙げることができ る。

【0024】上記一般式(15)に示す化合物として は、例えば、ロージクロロベンゼン、ロージブロモベン ゼン、ロージヨードベンゼン、ロージメチルスルフォニ ロキシベンゼン、2,3-ジクロロトルエン、2,3-ジブロモトルエン、2,3-ジョードトルエン、3,4 は、例えば、4,4'ージメチルスルフォニロキシピフ 50 ージクロロトルエン、3,4ージブロモトルエン、3,

4-ジヨードトルエン、2,3-ジメチルスルフォニロ キシベンゼン、3,4-ジメチルスルフォニロキシベン ゼン、mージクロロベンゼン、mージブロモベンゼン、 mージヨードベンゼン、mージメチルスルフォニロキシ ベンゼン、2,4-ジクロロトルエン、2,4-ジブロ モトルエン、2,4-ジョードトルエン、3,5-ジク ロロトルエン、3,5-ジブロモトルエン、3,5-ジ ヨードトルエン、2,6-ジクロロトルエン、2,6-ジブロモトルエン、2,6ージヨードトルエン、3,5 ージメチルスルフォニロキシトルエン、2,6ージメチ 10 ルスルフォニロキシトルエン、2,4-ジクロロベンゾ トリフルオライド、2,4-ジブロモベンゾトリフルオ ライド、2,4ージヨードベンゾトリフルオライド、 3, 5-ジクロロベンゾトリフルオライド、3, 5-ジ プロモトリフルオライド、3,5-ジヨードベンゾトリ フルオライド、1,3-ジブロモ-2,4,5,6-テ トラフルオロベンゼン、2,4-ジクロロベンジルアル コール、3,5-ジクロロベンジルアルコール、2,4 ージブロモベンジルアルコール、3,5ージブロモベン ジルアルコール、3,5-ジクロロフェノール、3,5 ージブロモフェノール、3,5-ジクロローt-ブトキ シカルボニロキシフェニル、3,5-ジブロモーtーブ トキシカルボニロキシフェニル、2,4-ジクロロ安息 香酸、3,5-ジクロロ安息香酸、2,4-ジブロモ安 息香酸、3,5-ジブロモ安息香酸、2,4-ジクロロ 安息香酸メチル、3,5-ジクロロ安息香酸メチル、 3,5-ジブロモ安息香酸メチル、2,4-ジブロモ安 息香酸メチル、2,4ージクロロ安息香酸-tーブチ ル、3,5-ジクロロ安息香酸-t-ブチル、2,4-ジブロモ安息香酸ー t ーブチル、3,5 ージブロモ安息 30 香酸-t-ブチルなどを挙げることもでき、好ましくは m-ジクロロベンゼン、2, 4-ジクロロトルエン、 3, 5-ジメチルスルフォニロキシトルエン、2, 4-ジクロロベンゾトリフルオライド、2,4-ジクロロベ ンゾフェノン、2,4-ジクロロフェノキシベンゼンな どである。上記一般式(15)に示す化合物は、1種単 独で、または2種以上を組み合わせて用いることができ る。

【0025】重合体(1)中の繰り返し構造単位の割合 は、上記一般式(1)において、gは5~100モル % 好ましくは5~95モル%、hは0~95モル%、 好ましくは0~90モル%、iは0~95モル%、好ま しくは0~90モル% (ただし、g+h+i=100モ ル%) である。gが5モル%未満(hまたはiが95モ ル%を超える)では、重合体の有機溶剤への溶解性が劣 る場合がある。

【0026】重合体(1)を製造する際に用いられる触 媒は、遷移金属化合物を含む触媒系が好ましく、この触 媒系としては、①遷移金属塩および配位子、または配位 子が配位された遷移金属(塩)、ならびに②還元剤を必 50 須成分とし、さらに、重合速度を上げるために、「塩」 を添加してもよい。

【0027】ここで、遷移金属塩としては、塩化ニッケ ル、臭化ニッケル、ヨウ化ニッケル、ニッケルアセチル アセトナートなどのニッケル化合物、塩化パラジウム、 臭化パラジウム、ヨウ化パラジウムなどのパラジウム化 合物、塩化鉄、臭化鉄、ヨウ化鉄などの鉄化合物、塩化 コバルト、臭化コバルト、ヨウ化コバルトなどのコバル ト化合物などを挙げることができる。これらのうち、特 に塩化ニッケル、臭化ニッケルなどが好ましい。

【0028】また、配位子としては、トリフェニルホス フィン、2, 2'ービピリジン、1,5-シクロオクタ ジエン、1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパ ンなどを挙げることができるが、トリフェニルホスフィ ン、2,2'ービピリジンが好ましい。上記配位子は、 1種単独でまたは2種以上を組合わせて用いることがで

【0029】さらに、あらかじめ配位子が配位された遷 移金属(塩)としては、例えば、塩化ニッケル2トリフ ェニルホスフィン、臭化ニッケル2トリフェニルホスフ イン、ヨウ化ニッケル2トリフェニルホスフィン、硝酸 ニッケル2-トリフェニルホスフィン、塩化ニッケル 2, 2'ビピリジン、臭化ニッケル2, 2'ビピリジ ン、ヨウ化ニッケル2, 2'ビピリジン、硝酸ニッケル 2, 2' E'ン) ニッケル、テトラキス (トリフェニルホスフィン) ニッケル、テトラキス (トリフェニルホスファイト) ニ ッケル、テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジ ウムなどを挙げることができるが、塩化ニッケル2トリ フェニルホスフィン、塩化ニッケル2、2′ビピリジン が好ましい。

【0030】このような触媒系において使用することが できる上記還元剤としては、例えば、鉄、亜鉛、マンガ ン、アルミニウム、マグネシウム、ナトリウム、カルシ ウムなどを挙げることできるが、亜鉛、マンガンが好ま しい。これらの還元剤は、酸や有機酸に接触させること により、より活性化して用いることができる。

【0031】また、このような触媒系において使用する ことのできる「塩」としては、フッ化ナトリウム、塩化 ナトリウム、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、硫酸 ナトリウムなどのナトリウム化合物、フッ化カリウム、 塩化カリウム、臭化カリウム、ヨウ化カリウム、硫酸カ リウムなどのカリウム化合物、フッ化テトラエチルアン モニウム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化テトラ エチルアンモニウム、ヨウ化テトラエチルアンモニウ ム、硫酸テトラエチルアンモニウムなどのアンモニウム 化合物などを挙げることができるが、臭化ナトリウム、 ヨウ化ナトリウム、臭化カリウム、臭化テトラエチルア ンモニウム、ヨウ化テトラエチルアンモニウムが好まし

【0032】このような触媒系における各成分の使用割合は、遷移金属塩または配位子が配位された遷移金属(塩)が、上記一般式(7)、(14)~(15)の化合物の総量1モルに対し、通常、0.0001~10モル、好ましくは0.01~0.5モルである。0.0001モル未満であると、重合反応が充分に進行せず、一方、10モルを超えると、分子量が低下することがある。

【0033】このような触媒系において、遷移金属塩および配位子を用いる場合、この配位子の使用割合は、遷 10移金属塩1モルに対し、通常、0.1~100モル、好ましくは1~10モルである。0.1モル未満では、触媒活性が不充分となり、一方、100モルを超えると、分子量が低下するという問題がある。

【0034】また、触媒系における還元剤の使用割合は、上記一般式(7)、(14)~(15)の化合物の総量1モルに対し、通常、0.1~100モル、好ましくは1~10モルである。0.1モル未満であると、重合が充分進行せず、一方、100モルを超えると、得られる重合体の精製が困難になることがある。

【0035】さらに、触媒系に「塩」を使用する場合、その使用割合は、上記一般式(7)、(14)~(15)の化合物の総量1モルに対し、通常、0.001~100モル、好ましくは0.01~1モルである。0.001モル未満であると、重合速度を上げる効果が不充分であり、一方、100モルを超えると、得られる重合体の精製が困難となることがある。

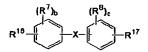
【0036】本発明で使用することのできる重合溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、ジメチルスルホキシド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、1ーメチルー2ーピロリドン、アーブチロラクトン、アーブチロラクタムなどを挙げることができ、テトラヒドロフラン、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、1ーメチルー2ーピロリドンが好ましい。これらの重合溶媒は、充分に乾燥してから用いることが好ましい。

【0037】重合溶媒中における上記一般式(7)、(14)~(15)の化合物の総量の濃度は、通常、1~100重量%、好ましくは5~40重量%である。

【0038】また、上記重合体を重合する際の重合温度は、通常、 $0\sim200$ ℃、好ましくは $50\sim80$ ℃である。また、重合時間は、通常、 $0.5\sim100$ 時間、好ましくは $1\sim40$ 時間である。なお、上記重合体(1)のポリスチレン換算の重量平均分子量は、通常、 $1,000\sim1,000,000$ である。

【0039】重合体(2);一般式(2)で表される重合体は、例えば、下記一般式(16)~(18)に示す化合物を含むモノマーを触媒系の存在下に重合することによって製造することができる。

【0040】一般式(16) 【化22】



【0041】[一般式 (16) 中、R⁷、R⁸はそれぞれ独立して炭素数1~20の炭化水素基、シアノ基、ニトロ基、炭素数1~20のアルコキシル基、アリール基またはハロゲン原子、Xは一CQQ'ー(ここでQ、Q'は同一であっても異なっていてもよく、ハロゲン化アルキル基、アルキル基、水素原子、ハロゲン原子またはアリール基を示す)に示す基、およびフルオレニレン基からなる群から選ばれる少なくとも1種であり、b、cは0~4の整数を示し、R¹⁶は、R¹⁷は水酸基、ハロゲン原子、一OM基(Mはアルカリ金属である)からなる群から選ばれる少なくとも1種を示す。]

【0042】前記一般式(16)に示す化合物(モノマ 一) の具体例としては、例えば2, 2-ビス(4-ヒド 20 ロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン、ビス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキシフ ェニル) ジフェニルメタン、2,2-ビス(4-ヒドロ キシー3ーメチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、 2, 2-ビス(4-ヒドロキシー3-プロペニルフェニ ル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-ヒド ロキシー3, 5ージメチルフェニル) ヘキサフルオロプ ロパン、2,2ービス(4-ヒドロキシフェニル)プロ パン、2, 2ービス(4ーヒドロキシー3ーメチルフェ ニル) プロパン、2, 2ービス(4ーヒドロキシー3ー プロペニルフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-ヒ ドロキシー3, 5-ジメチルフェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-ヒドロキシ-3-フルオロフェニル)プ ロパン、2, 2ービス(4ーヒドロキシー3, 5ージフ ルオロフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-クロロ フェニル) ヘキサフルオロプロパン、ビス (4-クロロ フェニル) メタン、ビス (4-クロロフェニル) ジフェ ニルメタン、2,2-ビス(4-クロロ-3-メチルフ ェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2ービス (4-クロロー3ープロペニルフェニル) ヘキサフルオロプロ パン、2, 2ービス(4ークロロー3, 5ージメチルフ ェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2ービス(4-クロロフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-クロロ -3-メチルフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-クロロー3ープロペニルフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-クロロ-3,5-ジメチルフェニル)プロパ ン、2,2-ビス(4-クロロ-3-フルオロフェニ ル) プロパン、2, 2-ビス(4-クロロー3, 5-ジ フルオロフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-クロ ロフェニル) ヘキサフルオロプロパン、ビス (4ーブロ 50 モフェニル) メタン、ピス (4 ーブロモフェニル) ジフ

ェニルメタン、2,2ービス(4ーブロモー3ーメチル フェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2ービス(4 ーブロモー3ープロペニルフェニル) ヘキサフルオロプ ロパン、2, 2-ビス(4-ブロモー3, 5-ジメチル フェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2ービス(4 ーブロモフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-ブロ モー3ーメチルフェニル)プロパン、2,2ービス(4 ーブロモー3ープロペニルフェニル)プロパン、2、2 ービス(4 ーブロモー3, 5 ージメチルフェニル)プロ パン、2,2-ビス(4-ブロモ-3-フルオロフェニ 10 ル)プロパン、2,2ービス(4ーブロモー3,5ージ フルオロフェニル) プロパン、ビス(4-フルオロフェ ニル) メタン、ビス (4-フルオロフェニル) ジフェニ ルメタン、2,2-ビス(4-フルオロー3-メチルフ ェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(4-フルオロー3ープロペニルフェニル) ヘキサフルオロプ ロパン、2,2ービス(4-フルオロ-3,5-ジメチ ルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2ービス (4-フルオロフェニル)プロパン、2,2-ビス(4 ーフルオロー3ーメチルフェニル)プロパン、2,2-20 ビス(4-フルオロ-3-プロペニルフェニル)プロパ ン、2,2-ビス(4-フルオロ-3,5-ジメチルフ ェニル)プロパン、2,2-ビス(4-フルオロ-3-フルオロフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-フル オロー3,5ージフルオロフェニル)プロパンなどを挙 げることができる。上記ビスフェノール化合物はナトリ ウム、カリウムなどを含有する塩基性化合物によって、 水酸基を-OM基 (Mはアルカリ金属である) に置換さ せても良い。本発明においては、前記一般式 (16) に 示す化合物を2種以上共重合することもできる。

【0043】一般式(17) 【化23】

【0044】 [一般式 (17) 中、R⁹、R¹⁰はそれぞ れ独立して炭素数1~20の炭化水素基、シアノ基、ニ トロ基、炭素数1~20のアルコキシル基、アリール基 またはハロゲン原子、R18は、R19は水酸基、ハロゲン 40 原子、-OM基 (Mはアルカリ金属である) からなる群 から選ばれる少なくとも1種を示し、Yは-O-、-C O-, -COO-, -CONH-, -S-, -SO2-およびフェニレン基の群から選ばれた少なくとも1種で あり、aは0または1を示し、d, eは0~4の整数を 示す。]

【0045】前記一般式 (17) に示す化合物として は、例えば、4,4'ージクロロビフェニル、4,4' ージブロモビフェニル、4,4'ージフルオロビフェニ

ロキシビフェニル、4,4'ージヒドロキシー3,3' ージプロペニルビフェニル、4,4′ージヒドロキシー 3, 3'ージメチルビフェニル、4, 4'ージヒドロキ シー3, 3' ージエチルビフェニル、4, 4' ージメチ ルヒドロキシー3,3',5,5'ーテトラフルオロビ フェニル、4,4'ージブロモオクタフルオロビフェニ ル、4,4-ジヒドロキシオクタフルオロビフェニル、 3, 3'ージアリルー4, 4'ービス(4ーヒドロキ シ) ビフェニル、4,4'ージクロロー2,2'ートリ フルオロメチルビフェニル、4,4'ージブロモー2, 2'ートリフルオロメチルビフェニル、4,4'ージヨ ードー2, 2′ートリフルオロメチルビフェニル、ビス (4-クロロフェニル) スルフォン、ビス (4-ヒドロ キシフェニル) スルフォン、ビス(4-クロロフェニ ル) エーテル、ビス (4-ヒドロキシフェニル) エーテ ル、4、4′ージクロロベンゾフェノン、4、4′ージ ヒドロキシベンゾフェノン、2,4-ジクロロベンゾフ ェノン、2,4-ジヒドロキシベンゾフェノンなどを挙 げることができる。上記ビスフェノール化合物はナトリ ウム、カリウムなどを含有する塩基性化合物によって、 水酸基を-OM基 (Mはアルカリ金属である) に置換さ せても良い。前記一般式(17)に示す化合物は、1種 単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができ る。

【0046】一般式(18) 【化24】

30

【0047】 [一般式 (18) 中、R¹¹は、炭素数1~ 20の炭化水素基、シアノ基、ニトロ基、炭素数1~2 0のアルコキシル基、アリール基またはハロゲン原子、 R^{14} , R^{15} d, $-OSO_2Z$ (ここで、Zdアルキル 基、ハロゲン化アルキル基またはアリール基を示 す。)、塩素原子、臭素原子または沃素原子を示し、 f は0~4の整数を示す。]

【0048】前記一般式(18)に示す化合物として は、例えば、1,2-ジヒドロキシベンゼン、1,3-ジヒドロキシベンゼン、1,4-ジヒドロキシベンゼ ン、2,3-ジヒドロキシトルエン、2,5-ジヒドロ キシトルエン、2,6-ジヒドロキシトルエン、3.4 ージヒドロキシトルエン、3,5-ジヒドロキシトルエ ン、o - ジクロロベンゼン、o - ジブロモベンゼン、o ージヨードベンゼン、oージメチルスルフォニロキシベ ンゼン、2,3-ジクロロトルエン、2,3-ジブロモ トルエン、2,3-ジョードトルエン、3,4-ジクロ ル、4 , 4' ージヨードビフェニル、4 , 4' ージヒド 50 ロトルエン、3 , 4 ージブロモトルエン、3 , 4 ージヨ 19

ードトルエン、2、3ージメチルスルフォニロキシベン ゼン、3,4-ジメチルスルフォニロキシベンゼン、m ージクロロベンゼン、mージブロモベンゼン、mージヨ ードベンゼン、mージメチルスルフォニロキシベンゼ ン、2,4-ジクロロトルエン、2,4-ジブロモトル エン、2,4-ジョードトルエン、3,5-ジクロロト ルエン、3,5-ジブロモトルエン、3,5-ジヨード トルエン、2,6ージクロロトルエン、2,6ージブロ モトルエン、2,6-ジョードトルエン、3,5-ジメ チルスルフォニロキシトルエン、2,6-ジメチルスル 10 フォニロキシトルエン、2,4-ジクロロベンゾトリフ ルオライド、2,4-ジブロモベンソトリフルオライ ド、2,4-ジヨードベンゾトリフルオライド、3.5 ージクロロベンゾトリフルオライド、3,5ージブロモ トリフルオライド、3,5-ジヨードベンソトリフルオ ライド、1,3-ジブロモー2,4,5,6-テトラフ ルオロベンゼン、2,4-ジクロロベンジルアルコー ル、3,5-ジクロロベンジルアルコール、2,4-ジ ブロモベンジルアルコール、3,5-ジブロモベンジル アルコール、3,5ージクロロフェノール、3,5ージ 20 プロモフェノール、3,5ージクロローtーブトキシカ ルボニロキシフェニル、3,5-ジブロモーtープトキ シカルボニロキシフェニル、2,4-ジクロロ安息香 酸、3,5-ジクロロ安息香酸、2,4-ジブロモ安息 香酸、3,5-ジブロモ安息香酸、2,4-ジクロロ安 息香酸メチル、3,5-ジクロロ安息香酸メチル、3, 5-ジブロモ安息香酸メチル、2,4-ジブロモ安息香 酸メチル、2,4-ジクロロ安息香酸-t-ブチル、 3,5-ジクロロ安息香酸-t-ブチル、2,4-ジブ ロモ安息香酸ー t ーブチル、3,5 - ジブロモ安息香酸 30 - t - ブチルなどを挙げることもできる。上記ビスフェ ノール化合物はナトリウム、カリウムなどを含有する塩 基性化合物によって、水酸基を-OM基(Mはアルカリ 金属である)に置換させても良い。前記一般式(18) に示す化合物は、1種単独で又は2種以上を組み合わせ て用いることができる。一般式(2)で表される重合体 中の繰り返し構造単位の割合は、上記一般式(2)にお いて、jは0~100モル%、kは0~100モル% (ただし、j+k=100モル%) である。

【0049】一般式(2)で表されるの重合体の合成方 40 法として、ビスフェノール化合物とジハロゲン化化合物 をアルカリ金属化合物の存在下で、溶剤中で加熱するこ とにより得られる。上記ビスフェノール化合物とジハロ ゲン化化合物の使用割合は、ビスフェノール化合物が4 5~55モル%、好ましくは48~52モル%、ジハロ ゲン化化合物が55~45モル%、好ましくは52~4 8モル%である。ビスフェノール化合物の使用割合が4 5未満や55を越えると重合体の分子量が上昇しにく く、塗膜の塗布性が劣る場合がある。この際使用するア ルカリ金属化合物としては、例えば水酸化ナトリウム、

水酸化カリウム、水酸化リチウム、炭酸ナトリウム、炭 酸カリウム、炭酸リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸 水素カリウム、炭酸水素リチウム、水素化ナトリウム、 水素化カリウム、水素化リチウム、金属ナトリウム、金 属カリウム、金属リチウムなどを挙げることができる。 これらは、1種または2種以上を同時に使用しても良 い。アルカリ金属化合物の使用量は、ビスフェノール化 合物に対して、通常、100~400モル%、好ましく は100~250モル%である。また、反応を促進させ るため、金属銅、塩化第一銅、塩化第二銅、臭化第一 銅、臭化第二銅、ヨウ化第一銅、ヨウ化第二銅、硫酸第 一銅、硫酸第二銅、酢酸第一銅、酢酸第二銅、ギ酸第一 銅、ギ酸第二銅などの助触媒を使用しても良い。この助 触媒の使用量は、ビスフェノール化合物に対し、通常、 1~50モル%、好ましくは1~30モル%である。

【0050】反応に使用する溶剤としては、例えばピリ ジン、キノリン、ベンゾフェノン、ジフェニルエーテ ル、ジアルコキシベンゼン(アルコキシル基の炭素数は 1~4)、トリアルコキシベンゼン(アルコキシル基の 炭素数は1~4)、ジフェニルスルホン、ジメチルスル ホキシド、ジメチルスルホン、ジエチルスルホキシド、 ジエチルスルホン、ジイソプロピルスルホン、テトラヒ ドロフラン、テトラヒドロチオフェン、スルホラン、N ーメチルー2-ピロリドン、N-エチルー2-ピロリド ン、ジメチルイミダ**ゾ**リジノン、γーブチロラクトン、 ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどを使 用することができる。これらは、1種または2種以上を 同時に使用しても良い。一般式(2)で表される重合体 を合成する際の反応濃度としては、モノマーの重量を基 準として、2~50重量%、反応温度としては50~2 50℃である。また、重合体合成時に生じる金属塩や未 反応モノマーを除去するため、反応溶液をろ過すること や反応溶液を重合体に対して貧溶剤である溶媒により再 沈殿や酸性、アルカリ性水溶液により洗浄することが好 ましい。このようにして得られる一般式(2)で表され る重合体のGPC法による重量平均分子量は、通常、5 00~500,000、好ましくは800~100,0 00である。

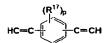
【0051】重合体(3);一般式(3)で表される重 合体は、例えば、下記一般式(19)及び一般式(2 0)

[0052]

【化25】一般式(19)

[0053]

【化26】一般式(20)



(式中、R¹²~R¹⁷および1~pは前記一般式 (3)に関して定義したとおりである。)で表わされる 化合物からなる群から選ばれる少なくとも一種の化合物 と、下記一般式(21)及び一般式(22) 【0054】

【化27】一般式(21)

$$X = \{R^{20}\}_r$$
 $R^{18} = \{R^{21}\}_s$
 $R^{19} = \{R^{22}\}_r$

【化28】一般式 (22)

(式中、R17~R22及びp~tは前記一般式(3)

に関して定義したとおりであり、Xはハロゲン原子を表 わす。)で表される化合物からなる群から選ばれる少な くとも1種の化合物とを触媒の存在下で重合する。 【0055】前記一般式(19)で表わされる化合物と しては、例えば、4,4'ージエチニルビフェニル、 3, 3'ージエチニルビフェニル、3, 4'ージエチニ ルビフェニル、4,4'ージエチニルジフェニルエーテ ル、3,3'ージエチニルジフェニルエーテル、3, 4'ージエチニルジフェニルエーテル、4,4'ージエ チニルベンゾフェノン、3,3'ージエチニルベンゾフ 30 ェノン、3,4'ージエチニルベンゾフェノン、4. 4'ージエチニルジフェニルメタン、3,3'ージエチ ニルジフェニルメタン、3,4'ージエチニルジフェニ ルメタン、4,4'ージエチニルベンゾイックアシッド フェニルエステル、3,3'ージエチニルベンゾイック アシッドフェニルエステル、3,4'ージエチニルベン ゾイックアシッドフェニルエステル、4,4'ージエチ ニルベンズアニリド、3,3'ージエチニルベンズアニ リド、3,4'ージエチニルベンズアニリド、4,4' -ジエチニルジフェニルスルフィド、3, 3' -ジエチ 40 ニルジフェニルスルフィド、3,4'ージエチニルジフ エニルスルフィド、4,4'ージエチニルジフェニルス ルホン、3,3'-ジエチニルジフェニルスルホン、 3, 4'ージエチニルジフェニルスルホン、2, 4, 4'ートリエチニルジフェニルエーテル、9,9ービス (4-エチニルフェニル) フルオレン、4,4"-ジエ チニルーp-ターフェニル、4,4"-ジエチニルーm ーターフェニル、4,4"ージエチニルーoーターフェ ニルなどを挙げることができる。これらの化合物は1種

単独で使用しても2種以上を同時に使用してもよい。

【0056】一般式(20)で表わされる化合物としては、例えば、1,2-ジエチニルベンゼン、1,3-ジエチニルベンゼン、2,5-ジエチニルトルエン,3,4-ジエチニルトルエンなどを挙げることができる。これらの化合物は1種単独で使用しても、2種以上を同時に使用してもよい。

で使用しても2種以上を同時に使用してもよい。 【0057】前記一般式(21)で表わされる化合物と しては、例えば、4,4'-ジクロロビフェニル、4, 4'-ジヨードビフェニル、4,4'-ジブロモビフェ 10 二ル、3,3'ージクロロビフェニル、3,3'ージヨ ードビフェニル、3,3'ージブロモビフェニル、3, 4'ージクロロビフェニル、3,4'ージヨードビフェ ニル、3,4'ージブロモビフェニル、4,4'ージク ロロジフェニルエーテル、4,4'ージヨードジフェニ ルエーテル、4,4'ージブロモジフェニルエーテル、 3, 3'ージクロロジフェニルエーテル、3, 3'ージ ヨードジフェニルエーテル、3,3'ージブロモジフェ ニルエーテル、3,4'ージクロロジフェニルエーテ ル、3,4'-ジヨードジフェニルエーテル、3,4' ージブロモジフェニルエーテル、4,4'ージクロロベ ンゾフェノン、4,4'ージヨードベンゾフェノン、 4, 4'ージブロモベンゾフェノン、3, 3'ージクロ ロベンゾフェノン、3,3'ージヨードベンゾフェノ ン、3,3'ージブロモベンゾフェノン、3,4'ージ クロロベンゾフェノン、3,4'ージヨードベンゾフェ ノン、3,4'ージブロモベンゾフェノン、4,4'ー ジクロロジフェニルメタン、4,4'ージヨードジフェ ニルメタン、4,4'ージプロモジフェニルメタン、 3, 3'ージクロロジフェニルメタン、3, 3'ージョ ードジフェニルメタン、3,3'ージブロモジフェニル メタン、3,4'ージクロロジフェニルメタン、3、 4'ージヨードジフェニルメタン、3、4'ージプロモ ジフェニルメタン、4,4'ージクロロベンソイックア シッドフェニルエステル、4,4'ージヨードベンゾイ ックアシッドフェニルエステル、4,4'ージブロモベ ンゾイックアシッドフェニルエステル、4,4'ージク ロロベンズアニリド、4,4'ージヨードベンズアニリ ド、4、4'ージブロモベンズアニリド、4、4'ージ クロロジフェニルスルフィド、4,4'ージヨードジフ ェニルスルフィド、4,4'ージブロモジフェニルスル フィド、3,3'ージクロロジフェニルスルフィド、 3, 3'ージヨードジフェニルスルフィド、3, 3'ー ジプロモジフェニルスルフィド、3,4'ージクロロジ フェニルスルフィド、3,4'ージヨードジフェニルス ルフィド、3,4'ージブロモジフェニルスルフィド、 4,4'-ジクロロジフェニルスルホン、4,4'-ジ ヨードジフェニルスルホン、4,4'ージブロモジフェ ニルスルホン、3,3'ージクロロジフェニルスルホ ン、3,3'ージヨードジフェニルスルホン、3,3' 50 ージブロモジフェニルスルホン、3,4'ージクロロジ

フェニルスルホン、3,4'ージヨードジフェニルスル ホン、3,4'ージブロモジフェニルスルホン、2, 2'ービス(4ークロロフェニル)イソプロピリデン、 2, 2'-ビス(4-ヨードフェニル) イソプロピリデ ン、2,2'ービス(4ーブロモフェニル)イソプロピ リデン、2, 2'ービス(3ークロロフェニル)イソプ ロピリデン、2, 2'ービス(3-ヨードフェニル)イ ソプロピリデン、2, 2'ービス(3ーブロモフェニ ル) イソプロピリデン、2,2'ービス(4-クロロフ ェニル) ヘキサフルオロイソプロピリデン、2, 2' - 10 ビス (4-ヨードフェニル) ヘキサフルオロイソプロピ リデン、2,2'ービス(4ーブロモフェニル)へキサ フルオロイソプロピリデン、2,2'ービス(3-クロ ロフェニル) ヘキサフルオロイソプロピリデン、2. 2'ービス(3ーヨードフェニル)へキサフルオロイソ プロピリデン、2,2'ービス(3ーブロモフェニル) ヘキサフルオロイソプロピリデン、2,2'ービス(4 -クロロフェニル)ジフェニルメチリデン、2,2'-ビス (4-ヨードフェニル) ジフェニルメチリデン、 2, 2'ービス(4ープロモフェニル)ジフェニルメチ リデン、2, 2'ービス(3ークロロフェニル)ジフェ ニルメチリデン、2,2'ービス(3ーヨードフェニ ル) ジフェニルメチリデン、2,2'ービス(3ーブロ モフェニル) ジフェニルメチリデン、9,9-ビス(4 ークロロフェニル) フルオレン、9,9ービス(4-ヨ ードフェニル)フルオレン、9、9ービス(4ーブロモ フェニル) フルオレン、9,9-ビス(3-クロロフェ ニル)フルオレン、9,9ービス(3-ヨードフェニ ル) フルオレン、9, 9-ビス(3-ブロモフェニル) フルオレン、4,4"ージクロローmーターフェニル、 4, 4" ージヨードーmーターフェニル、4, 4" ージ ブロモーmーターフェニル、4,4"ージクロローpー ターフェニル、4, 4"ージヨード-p-ターフェニ ル、4,4"ージブロモーpーターフェニルなどを挙げ ることができる。これらの化合物は1種単独で使用して も2種以上を同時に使用してもよい。

【0058】前記一般式(22)で表わされる化合物と しては、例えば、1,2-ジクロロベンゼン、1,3-ジクロロベンゼン、1,4-ジクロロベンゼン、1,2 ージヨードベンゼン、1,3-ジョードベンゼン、1, 4 - ジョードベンゼン、1, 2 - ジブロモベンゼン、1, 3 - ジブロモベンゼン、1, 4 - ジブロモベンゼ ン、2,3-ジクロロトルエン、2,4-ジクロロトル エン、2,5-ジクロロトルエン、2,6-ジクロロト ルエン、3,4-ジクロロトルエン、2,3-ジヨード トルエン、2,4ージヨードトルエン、2,5ージヨー ドトルエン、2,6-ジョードトルエン、3,4-ジョ ードトルエン、2,3ージブロモトルエン、2,4ージ ブロモトルエン、2,5-ジブロモトルエン、2,6げることができる。これらの化合物は1種単独で使用し ても2種以上を同時に使用してもよい。

【0059】本発明の重合体は、前記一般式(19)で 表される化合物及び/又は一般式(20)で表される化 合物と、一般式(21)で表される化合物及び/又は一 般式(22)で表される化合物を触媒の存在下で重合さ せることにより製造され、この際一般式(19)で表さ れる化合物及び/又は一般式(20)で表される化合物 と、一般式(21)で表される化合物及び/又は一般式 (22)で表される化合物の使用割合は、前者の化合物 の総量1モルに対して、後者の化合物の総量が0.8~ 1. 2モル、好ましくは0. 9~1. 1モル、特に好ま しくは0.95~1.05である。後者の化合物の総量 が0.8モル未満の場合や1.2モルを越える場合は、 得られる重合体の分子量が上昇しにくい。

【0060】本発明の製造方法においては、これらの化 合物を遷移金属化合物を含む触媒の存在下で重合させる ことが好ましい。さらに、遷移金属化合物及び塩基件化 合物を含む触媒がより好ましく、特に下記の(a)、

(b) 及び(c) 成分から構成されているものが特に好 ましい。

(a) パラジウム塩及びパラジウムに対し配位子として 結合するか、配位子として結合する基(原子団)を供給 して錯体(錯イオンを含む)を形成し得る物質(以下、 配位子形成体という)、又はパラジウム錯体(必要に応 じて配位子形成体をさらに加えてもよい)

(b) 1 価の銅化合物

(c) 塩基性化合物

【0061】パラジウム塩としては、例えば、塩化パラ ジウム、臭化パラジウム、ヨウ化パラジウム等を挙げる ことができる。配位子形成体としては、例えば、トリフ ェニルホスフィン、トリーo-トリルホスフィン、トリ シアノフェニルホスフィン、トリシアノメチルホスフィ ン等を挙げることができる。中でも、トリフェニルホス フィンが好ましい。これらの化合物は1種単独で使用し ても2種以上を同時に使用してもよい。

【0062】パラジウム錯体としては、例えば、ジクロ ロビス (トリフェニルホスフィン) パラジウム、ジブロ モビス (トリフェニルホスフィン) パラジウム、ジヨー ドビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、ジクロ ロビス (トリーロートリルホスフィン) パラジウム、ジ クロロビス (トリシアノフェニルホスフィン) パラジウ ム、ジクロロビス(トリシアノメチルホスフィン)パラ ジウム、ジブロモビス (トリーロートリルホスフィン) パラジウム、ジブロモビス(トリシアノフェニルホスフ ィン) パラジウム、ジブロモビス (トリシアノメチルホ スフィン) パラジウム、ジヨードビス (トリーロートリ ルホスフィン) パラジウム、ジヨードビス (トリシアノ フェニルホスフィン) パラジウム、ジョードビス (トリ ジブロモトルエン、3,4-ジブロモトルエンなどを挙 50 シアノメチルホスフィン)パラジウム、テトラキス(ト

リフェニルホスフィン)パラジウム、テトラキス(トリーoートリルホスフィン)パラジウム、テトラキス(トリシアノフェニルホスフィン)パラジウム、テトラキス(トリシアノメチルホスフィン)パラジウム等を挙げることができる。中でも、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウムが好ましい。これらの化合物は1種単独で使用しても2種以上を同時に使用してもよい。

【0063】1価の銅化合物としては、例えば、塩化銅(I)、臭化銅(I)、ヨウ化銅(I)等を挙げること 10ができる。これらの化合物は1種単独で使用しても2種以上を同時に使用してもよい。

【0064】上記触媒の使用割合は、下記のとおりである。パラジウム塩の使用割合は、一般式(19)~(22)で表される化合物の総量1モルに対し、好ましくは、0.0001~10モル、さらに好ましくは、0.001~1モルである。0.0001モル未満であると重合が十分に進行しないことがあり、一方、10モルを超えると精製が困難となることがある。

【0065】また、配位子形成体の使用割合は、一般式 20 (19)~(22)で表される化合物の総量1モルに対 し、好ましくは、0.0004~50モル、さらに好ま しくは0.004~5モルである。0.0004モル未 満であると重合が十分に進行しないことがあり、一方、 50モルを超えると精製が困難となることがある。パラ ジウム錯体の使用割合は、一般式(19)~(22)で 表される化合物の総量1モルに対し、好ましくは、0. 0001~10モル、さらに好ましくは0.001~1 モルである。0.0001モル未満であると重合が十分 に進行しないことがあり、一方、10モルを超えると精 30 製が困難となることがある。1価の銅化合物の使用割合 は、一般式(19)~(22)で表される化合物の総量 1モルに対し、好ましくは、0.0001~10モル、 さらに好ましくは0.001~1モルである。0.00 01モル未満であると重合が十分に進行しないことがあ り、一方、10モルを超えると精製が困難となることが ある。

【0066】塩基性化合物としては、例えば、ピリジン、ピロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、 ピコリン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、ジメチルモノエタノールアミン、モノメチルジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノメチルジエタノールアミン、トリエタノールアミン、ジアザビシクロオクタン、ジアザビシクロノナン、ジアザビシクロウンデセン、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド、ジエチルアミン、アンモニア、nーブチルアミン、イミダゾール等を挙げることができる。中でも、ジエチルアミン、ピペリジン、nーブチルアミンが好ましい。これらの化合物は1種単独で使用しても2種以上を同時に使用してもよい。 【0067】塩基性化合物の使用割合は、一般式(19)~(22)で表される化合物の総量1モルに対し、好ましくは、1~1000モル、さらに好ましくは1~100モルである。1モル未満であると重合が十分に進行しないことがあり、一方、100モルを超えると経済的ではなくなる。

【0068】本発明の製造方法では、必要に応じて溶媒 を用いることができる。重合溶媒としては特に制限はな いが、例えば、クロロホルム、ジクロロメタン、1、2 ージクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン 等のハロゲン系溶媒;ベンゼン、トルエン、キシレン、 メシチレン、ジエチルベンゼン等の芳香族炭化水素系溶 媒;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサ ン、ジグライム、アニソール、ジエチレンクリコールジ メチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテ ル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル等のエ ーテル系溶媒;アセトン、メチルエチルケトン、2-へ プタノン、シクロヘキサノン、シクルペンタノン等のケ トン系溶媒; 酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、 酢酸ブチル、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸ブチル、γ ーブチロラクトン等のエステル系溶媒: N. N-ジメチ ルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルー2-ピロリドン等のアミド系溶媒等を挙げるこ とができる。これらの溶媒は十分に乾燥、脱酸素して用 いることが好ましい。これらの溶媒は1種単独で使用し ても2種以上を同時に使用してもよい。

【0069】重合溶媒中におけるモノマー(重合成分) 濃度は、好ましくは、 $1\sim80$ 重量%、さらに好ましく は $5\sim60$ 重量%である。また、重合温度は、好ましく は、 $0\sim150$ °C、さらに好ましくは $5\sim100$ °Cであ る。また、重合時間は、好ましくは、 $0.5\sim100$ 時 間、さらに好ましくは $1\sim40$ 時間である。

【0070】(B)有機溶剤

本発明の膜形成用組成物は、(A)成分および(C)成 分を、(B)有機溶剤に溶解または分散してなる。本発 明に使用する(B)有機溶剤としては、例えば、nーペ ンタン、iーペンタン、n-ヘキサン、i-ヘキサン、 n-ヘプタン、i-ヘプタン、2, 2, 4-トリメチル ペンタン、nーオクタン、iーオクタン、シクロヘキサ ン、メチルシクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素系溶 媒;ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、 トリメチルベンゼン、メチルエチルベンゼン、n-プロ ピルベンセン、i-プロピルベンセン、ジエチルベンゼ ン、iーブチルベンゼン、トリエチルベンゼン、ジーi ープロピルベンセン、nーアミルナフタレン、トリメチ ルベンゼンなどの芳香族炭化水素系溶媒;メタノール、 エタノール、nープロパノール、iープロパノール、n ーブタノール、iーブタノール、secーブタノール、 tーブタノール、nーペンタノール、iーペンタノー

50 ル、2-メチルブタノール、sec-ペンタノール、t

-ペンタノール、3-メトキシブタノール、n-ヘキサ ノール、2ーメチルペンタノール、secーヘキサノー ル、2-エチルブタノール、sec-ヘプタノール、ヘ プタノールー3、nーオクタノール、2ーエチルヘキサ ノール、secーオクタノール、n-ノニルアルコー ル、2,6ージメチルヘプタノールー4、nーデカノー ル、secーウンデシルアルコール、トリメチルノニル アルコール、secーテトラデシルアルコール、sec ーヘプタデシルアルコール、フェノール、シクロヘキサ ノール、メチルシクロヘキサノール、3,3,5ートリ メチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール、フェ ニルメチルカルビノール、ジアセトンアルコール、クレ ソールなどのモノアルコール系溶媒:エチレングリコー ル、1,2-プロピレングリコール、1,3-ブチレン グリコール、ペンタンジオールー2,4、2-メチルペ ンタンジオールー2, 4、ヘキサンジオールー2, 5、 ヘプタンジオールー2,4、2-エチルヘキサンジオー ルー1, 3、ジエチレングリコール、ジプロピレングリ コール、トリエチレングリコール、トリプロピレングリ コール、グリセリンなどの多価アルコール系溶媒;アセ トン、メチルエチルケトン、メチルーnープロピルケト ン、メチルーnーブチルケトン、ジエチルケトン、メチ ルーiーブチルケトン、メチルーnーペンチルケトン、 ン、ジーiーブチルケトン、トリメチルノナノン、シク ロヘキサノン、シクロペンタノン、2-ヘキサノン、メ チルシクロヘキサノン、2,4-ペンタンジオン、アセ トニルアセトン、ジアセトンアルコール、アセトフェノ ン、フェンチョンなどのケトン系溶媒;エチルエーテ ル、i ープロピルエーテル、n ーブチルエーテル、n ー ヘキシルエーテル、2-エチルヘキシルエーテル、エチ レンオキシド、1,2-プロピレンオキシド、ジオキソ **ラン、4 -メチルジオキソラン、ジオキサン、ジメチル** ジオキサン、エチレングリコールモノメチルエーテル、 エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリ コールジエチルエーテル、エチレングリコールモノーn ーブチルエーテル、エチレングリコールモノーn-ヘキ シルエーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテ ル、エチレングリコールモノー2-エチルブチルエーテ ル、エチレングリコールジブチルエーテル、ジエチレン 40 グリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコール モノエチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエ ーテル、ジエチレングリコールモノーnーブチルエーテ ル、ジエチレングリコールジ-n-ブチルエーテル、ジ エチレングリコールモノーnーヘキシルエーテル、エド キシトリグリコール、テトラエチレングリコールジーn ーブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエ ーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プ ロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレン グリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコー 50

ルモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエ チルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、テトラヒドロフラン、2-メチルテトラヒドロ フランなどのエーテル系溶媒;ジエチルカーボネート、 酢酸メチル、酢酸エチル、ィーブチロラクトン、ィーバ レロラクトン、酢酸nープロピル、酢酸iープロピル、 酢酸nーブチル、酢酸iーブチル、酢酸secーブチ ル、酢酸n-ペンチル、酢酸sec-ペンチル、酢酸3 -メトキシブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸2-エチ ルブチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、酢 酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸n ーノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢酸 エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレン グリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコ ールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモ ノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノーn ーブチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメチ ルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエー テル、酢酸プロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、酢 酸ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジ プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリ コール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エ チル、プロピオン酸nーブチル、プロピオン酸iーアミ ル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジーn-ブチル、乳酸 メチル、乳酸エチル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミ ル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジ エチルなどのエステル系溶媒; N-メチルホルムアミ ド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジエチル ホルムアミド、アセトアミド、Nーメチルアセトアミ ド、N、N-ジメチルアセトアミド、N-メチルプロピ オンアミド、Nーメチルピロリドンなどの含窒素系溶 媒;硫化ジメチル、硫化ジエチル、チオフェン、テトラ ヒドロチオフェン、ジメチルスルホキシド、スルホラ ン、1、3-プロパンスルトンなどの含硫黄系溶媒など を挙げることができる。これらの溶剤は、1種単独でま

【0071】(C)成分

本発明の膜形成用組成物には、フラーレンおよび/またはカーボンナノチューブを含有する。(C)成分を含有することで、塗膜弾性率が高くかつ低比誘電率の塗膜が得られる。

たは2種以上を組み合わせて用いることができる。

【0072】かかる(C)成分としては、例えばフラーレンC60、フラーレンC70、フラーレンC76、フラーレンC78、フラーレンC82、単層カーボンナノチュウーブ、多層カーボンナノチューブなどを挙げることが出来る。(C)成分は2種以上を同時に使用することが出来る。

【0073】(A)成分に対する(C)成分の使用割合 は、(A)成分100重量部(完全加水分解縮合物機 10

算)に対して(C)成分5~50重量部であり、(C) 成分の使用量が5重量部未満であると2. 5以下の比誘 電率の塗膜が得られ難く、50重量部を越えると塗膜の リーク電流が増加する。

【0074】その他の添加剤

本発明の膜形成用組成物には、さらにコロイド状シリ カ、コロイド状アルミナ、(A)成分以外の有機ポリマ ー、界面活性剤、シランカップリング剤、トリアゼン化 合物、ラジカル発生剤、重合性の二重結合を含有する化 合物 重合性の三重結合などの成分を添加してもよい。 コロイド状シリカとは、例えば、高純度の無水ケイ酸を 前記親水性有機溶媒に分散した分散液であり、通常、平 均粒径が5~30mμ、好ましくは10~20mμ、固 形分濃度が10~40重量%程度のものである。このよ うな、コロイド状シリカとしては、例えば、日産化学工 業(株)製、メタノールシリカゾルおよびイソプロパノ ールシリカゾル;触媒化成工業(株)製、オスカルなど が挙げられる。コロイド状アルミナとしては、日産化学 工業(株)製のアルミナゾル520、同100、同20 0;川研ファインケミカル(株)製のアルミナクリアー 20 ゾル、アルミナゾル10、同132などが挙げられる。 上記有機ポリマーとしては、例えば、糖鎖構造を有する 重合体、ビニルアミド系重合体、(メタ)アクリル系重 合体、芳香族ビニル化合物系重合体、デンドリマー、ポ リイミド、ポリアミック酸、ポリアミド、ポリキノキサ リン、ポリオキサジアゾール、フッ素系重合体、ポリア ルキレンオキサイド構造を有する重合体などを挙げるこ とができる。

【0075】ポリアルキレンオキサイド構造を有する重 合体としては、ポリメチレンオキサイド構造、ポリエチ 30 レンオキサイド構造、ポリプロピレンオキサイド構造、 ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリブチレンオキ シド構造などを有する重合体が挙げられる。具体的に は、ポリオキシメチレンアルキルエーテル、ポリオキシ エチレンアルキルエーテル、ポリオキシエテチレンアル キルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンステロール エーテル、ポリオキシエチレンラノリン誘導体、アルキ ルフェノールホルマリン縮合物の酸化エチレン誘導体、 ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポ リマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアル 40 キルエーテルなどのエーテル型化合物、ポリオキシエチ レングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソ ルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビト ール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカ ノールアミド硫酸塩などのエーテルエステル型化合物、 ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、エチレングリ コール脂肪酸エステル、脂肪酸モノグリセリド、ポリグ リセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、 プロピレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エ ステルなどのエーテルエステル型化合物などを挙げるこ 50 活性剤を挙げることができる。また、市販品としては、

とができる。ポリオキシチレンポリオキシプロピレンブ ロックコポリマーとしては、下記のようなブロック構造 を有する化合物が挙げられる。

- -(X') x (Y') y -
- -(X')x-(Y')y-(X')z-

〔一般式中、X'は-CH2 CH2 O-で表される 基を、Y'は-CH2CH(CH3)O-で表される 基を示し、xは1~90、yは10~99、zは0~9 0の数を示す。〕

【0076】これらの中で、ポリオキシエチレンアルキ ルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン ブロックコポリマー、ポリオキシエチレンポリオキシプ ロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレングリセ リン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂 肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸 エステル、などのエーテル型化合物をより好ましい例と して挙げることができる。これらは、1種あるいは2種 以上を同時に使用しても良い。

【0077】界面活性剤としては、例えば、ノニオン系 界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活 性剤、両性界面活性剤などが挙げられ、さらには、フッ 素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤、ポリアルキ レンオキシド系界面活性剤、ポリ(メタ)アクリレート **系界面活性剤などを挙げることができ、好ましくはフッ** 素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤を挙げること ができる。

【0078】フッ素系界面活性剤としては、例えば、 1, 1, 2, 2-テトラフロロオクチル (1, 1, 2, 2ーテトラフロロプロピル) エーテル、1, 1, 2, 2 ーテトラフロロオクチルヘキシルエーテル、オクタエチ レングリコールジ(1, 1, 2, 2-テトラフロロブチ ル) エーテル、ヘキサエチレングリコール(1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロペンチル) エーテル、オ クタプロピレングリコールジ(1, 1, 2, 2ーテトラ フロロブチル) エーテル、ヘキサプロピレングリコール 5 $(1, 1, 2, 2, 3, 3- \Lambda + サフロロペンチル)$ エーテル、パーフロロドデシルスルホン酸ナトリウム、 1, 1, 2, 2, 8, 8, 9, 9, 10, 10ーデカフ ロロドデカン、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロ デカン、N-[3-(パーフルオロオクタンスルホンア ミド) プロピル] -N, N' -ジメチル-N-カルボキ シメチレンアンモニウムベタイン、パーフルオロアルキ ルスルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、 パーフルオロアルキルーN-エチルスルホニルグリシン 塩、リン酸ビス(Nーパーフルオロオクチルスルホニル -N-エチルアミノエチル)、モノパーフルオロアルキ ルエチルリン酸エステルなどの末端、主鎖および側鎖の 少なくとも何れかの部位にフルオロアルキルまたはフル オロアルキレン基を有する化合物からなるフッ素系界面

メガファックF142D、同F172、同F173、同 F183 (以上、大日本インキ化学工業(株)製)、エ フトップEF301、同303、同352 (新秋田化成 (株) 製)、フロラードFC-430、同FC-431 〔住友スリーエム (株) 製〕、アサヒガードAG71 0、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-104、同SC-1 05、同SC-106 [旭硝子 (株) 製]、BM-10 00、BM-1100 [裕商 (株) 製]、NBX-15 〔(株)ネオス〕などの名称で市販されているフッ素系 界面活性剤を挙げることができる。これらの中でも、上 記メガファックF172, BM-1000, BM-11 00, NBX-15が特に好ましい。シリコーン系界面 活性剤としては、例えば、SH7PA、SH21PA、 SH30PA、ST94PA [いずれも東レ・ダウコー ニング・シリコーン (株) 製) などを用いることができ る。これらの中でも、上記SH28PA、SH30PA が特に好ましい。界面活性剤の使用量は、(A)成分1 00重量部に対して、通常、0.0001~1重量部 である。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用 20 しても良い。

【0079】シランカップリング剤としては、例えば、 3ーグリシジロキシプロピルトリメトキシシラン、3-アミノグリシジロキシプロピルトリエトキシシラン、3 ーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、3ーゲ リシジロキシプロピルメチルジメトキシシラン、1-メ タクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、3-ア ミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピル トリエトキシシラン、2-アミノプロピルトリメトキシ シラン、2-アミノプロピルトリエトキシシラン、N- 30 (2-アミノエチル) -3-アミノプロピルトリメトキ シシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロ ピルメチルジメトキシシラン、3-ウレイドプロピルト リメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリエトキシ シラン、 N-エトキシカルボニル-3-アミノプロピル トリメトキシシラン、N-エトキシカルボニルー3-ア ミノプロピルトリエトキシシラン、Nートリエトキシシ リルプロピルトリエチレントリアミン、Nートリエトキ シシリルプロピルトリエチレントリアミン、10-トリ メトキシシリルー1, 4, 7ートリアザデカン、10-トリエトキシシリルー1,4,7ートリアザデカン、9 ートリメトキシシリルー3,6-ジアザノニルアセテー ト、9-トリエトキシシリル-3,6-ジアザノニルア セテート、N-ベンジル-3-アミノプロピルトリメト キシシラン、N-ベンジル-3-アミノプロピルトリエ トキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルトリ メトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルト リエトキシシラン、N-ビス (オキシエチレン) -3-アミノプロピルトリメトキシシラン、Nービス(オキシ エチレン) -3-アミノプロピルトリエトキシシランな 50

どが挙げられる。これらは、1種あるいは2種以上を同 時に使用しても良い。

【0080】トリアゼン化合物としては、例えば、1, 2-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、 1, 3-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル) ベンゼ ン、1,4-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)ベ ンゼン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニルフェニ ル) エーテル、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニルフ ェニル) メタン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル フェニル)スルホン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼ ニルフェニル)スルフィド、2,2-ビス [4-(3, 3-ジメチルトリアゼニルフェノキシ)フェニル]-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、 2, 2-ビス〔4-(3, 3-ジメチルトリアゼニルフ ェノキシ)フェニル)プロパン、1,3,5-トリス (3, 3-ジメチルトリアゼニル) ベンゼン、2, 7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス [4-(3, 3-ジメチルトリアゼニル) フェニル] フ ルオレン、2, 7ービス(3, 3ージメチルトリアゼニ ル) -9, 9-ビス [3-メチル-4-(3, 3-ジメ チルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2,7-ビ ス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス [3-フェニルー4-(3, 3-ジメチルトリアゼニ ル) フェニル] フルオレン、2, 7ービス(3, 3ージ メチルトリアゼニル) -9, 9-ビス [3-プロペニル -4-(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル]フ ルオレン、2, 7-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニ ル) -9, 9-ビス [3-フルオロ-4-(3, 3-ジ メチルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2、7-ビス (3, 3-ジメチルトリアゼニル) -9, 9-ビス [3, 5ージフルオロー4ー(3, 3ージメチルトリア ゼニル) フェニル] フルオレン、2, 7-ビス(3, 3 ージメチルトリアゼニル) -9,9-ビス[3-トリフ ルオロメチルー4ー(3,3ージメチルトリアゼニル) フェニル] フルオレンなどが挙げられる。これらは、1 種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

【0081】ラジカル発生剤としては、例えば、イソブチリルパーオキサイド、 α , α' ービス(ネオデカノイルパーオキシ)ジイソプロピルベンゼン、クミルパーオキシネオデカノエート、ジーnプロピルパーオキシジカーボネート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、1,1,3,3ーテトラメチルブチルパーオキシネオデカノエート、ビス(4-t-ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート、1-シクロヘキシル)パーオキシジカーボネート、1-シクロヘキシル)1ーメチルエチルパーオキシネオデカノエート、ジー2ーエトキシエチルパーオキシジカーボネート、1-02ーエチルペキシルパーオキシジカーボネート、1-02ーオキシジカーボネート、1-02ーオキシジカーボネート、1-03ーメトキシブチルパーオキシ)ジカーボネート、1-03ーメトキシブチルパーオキシ)ジカーボネート、1-03ーメトキシブチルパーオキシ)ジカーボネート、1-03ーメトキシブチルパーオキシ)ジカーボネート、1-03ーメート

キシネオデカノエート、2,4-ジクロロベンゾイルパ ーオキサイド、t-ヘキシルパーオキシピバレート、t ーブチルパーオキシピバレート、3,5,5ートリメチ ルヘキサノイルパーオキサイド、オクタノイルパーオキ サイド、ラウロイルパーオキサイド、ステアロイルパー オキサイド、1, 1, 3, 3ーテトラメチルブチルパー オキシ2-エチルヘキサノエート、スクシニックパーオ キサイド、2、5ージメチルー2、5ージ(2ーエチル ヘキサノイルパーオキシ) ヘキサン、1-シクロヘキシ ルー1-メチルエチルパーオキシ2-エチルヘキサノエ 10 ート、t-ヘキシルパーオキシ2-エチルヘキサノエー ト、t ーブチルパーオキシ2 ーエチルヘキサノエート、 m-トルオイルアンドベンゾイルパーオキサイド、ベン ゾイルパーオキサイド、tーブチルパーオキシイソブチ レート、ジーtーブチルパーオキシー2-メチルシクロ ヘキサン、1, 1-ビス(t-ヘキシルパーオキシ)-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン、1, 1-ビス (t-ヘキシルパーオキシ)シクロヘキサン、1,1-ビス(tーブチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチ ルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキ シ) シクロヘキサン、2, 2-ビス(4, 4-ジーt-ブチルパーオキシシクロヘキシル)プロパン、1,1-ビス (tーブチルパーオキシ) シクロデカン、tーへキ シルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、tーブ チルパーオキシマレイン酸、tーブチルパーオキシー 3, 3, 5-トリメチルヘキサノエート、tーブチルパ ーオキシラウレート、2,5ージメチルー2,5ージ (m-トルオイルパーオキシ) ヘキサン、t-ブチルパ ーオキシイソプロピルモノカーボネート、tーブチルパ ーオキシ2-エチルヘキシルモノカーボネート、t-へ 30 キシルパーオキシベンゾエート、2,5-ジメチルー 2, 5-ジ(ベンゾイルパーオキシ) ヘキサン、 t-ブ チルパーオキシアセテート、2,2-ビス(t-ブチル パーオキシ) ブタン、t ーブチルパーオキシベンゾエー ト、nーブチルー4, 4ービス(tーブチルパーオキ シ) バレレート、ジーtーブチルパーオキシイソフタレ ート、 α , α' ービス (t-ブチルパーオキシ) ジイソプロピルベンゼン、ジクミルパーオキサイド、2,5-ジメチルー2, 5-ジ (t-ブチルパーオキシ) ヘキサ ン、tーブチルクミルパーオキサイド、ジーtーブチル 40 パーオキサイド、p-メンタンヒドロパーオキサイド、 2, 5-ジメチル-2, 5-ジ (t-ブチルパーオキ シ) ヘキシン-3、ジイソプロピルベンゼンヒドロパー オキサイド、tーブチルトリメチルシリルパーオキサイ ド、1, 1, 3, 3ーテトラメチルブチルヒドロパーオ キサイド、クメンヒドロパーオキサイド、t-ヘキシル ヒドロパーオキサイド、tーブチルヒドロパーオキサイ ドなどの有機過酸化物;ジベンジル、2、3-ジメチル -2, 3-3

ルー α -メトキシビベンジル、 α , α' -ジフェニルー α , α' -ジメトキシビベンジル、 α , α' -ジメトキシー α , α' -ジメチルビベンジル、 α , α' -ジメトキシビベンジル、 α , α' -ジメチルビベンジル、 α , α' -ジメトキシビベンジル、 α , α' -ジメチルー α , α' -ジストカールー α -カールー α -

【0082】重合性の二重結合を含有する化合物として は、例えば、アリルベンゼン、ジアリルベンゼン、トリ アリルベンゼン、アリルオキシベンゼン、ジアリルオキ シベンゼン、トリアリルオキシベンゼン、α, ・ージア リルオキシアルカン類、α、・ージアリルアルケン類、 α, ・ージアリルアルケン類、アリルアミン、ジアリル アミン、トリアリルアミン、N一アリルフタルイミド、 Nーアリルピロメリットイミド、N、N'ージアリルウ レア、トリアリルイソシアヌレート、2,2'ージアリ ルビスフェノールAなどのアリル化合物;スチレン、ジ ビニルベンゼン、トリビニルベンゼン、スチルベン、プ ロペニルベンゼン、ジプロペニルベンゼン、トリプロペ ニルベンゼン、フェニルビニルケトン、メチルスチリル ビニルアルケン類 α, α'ージビニルアルキン類、 α , α ' -ジビニルオキシアルカン類、 α , α ' -ジビ ニルアルケン類、 α , α ージビニルアルキン類、 α , α' -ジアクリルオキシアルカン類 α , α' -ジアク リルアルケン類、 α , α ージアクリルアルケン類、 α , α' 一ジメタクリルオキシアルカン類、 α , α' — ジメタクリルアルケン類、α, α' -ジメタクリルアル ケン類、ビスアクリルオキシベンゼン、トリスアクリル オキシベンゼン、ビスメタクリルオキシベンゼン、トリ スメタクリルオキシベンゼン、Nービニルフタルイミ ド、Nービニルピロメリットイミドなどのビニル化合 物;2,2'-ジアリル-4,4'-ビフェノールを含 むポリアリーレンエーテル、2,2'ージアリルー4, 4' -ビフェノールを含むポリアリーレンなどを挙げる ことができる。これらは、1種または2種以上を同時に 使用しても良い。

【0083】重合性の三重結合を含有する化合物としては、例えば、下記一般式(23)および一般式(24)で表される化合物もしくはいずれか一方が挙げられる。

【0084】一般式(23)

【化29】

【0085】 【化30】一般式 (24)

$$=$$
 \mathbb{R}^2

【0086】(一般式中、R24は $2\sim v$ 価の芳香族基を示し、R25は $2\sim w$ 価の芳香族基を示し、R23は 炭素数 $1\sim 3$ のアルキル基を示し、うは $0\sim 5$ の整数を示し、v およびwはそれぞれ独立に $2\sim 6$ の整数である。)

【0087】上記一般式 (23) において、R23は炭素数1~3のアルキル基であり、メチル基、エチル基、*

* n - プロピル基、i - プロピル基を挙げることができる。また、一般式(23)におけるR24および一般式(24)におけるR25は、それぞれ2~v価および2~w価の芳香族基であり、例えば、以下の一般式(25)に示す基を挙げることができる。

【0088】一般式 (25) 【化31】

【0089】 [上記一般式中、Mは-O-、-S-、-CH2 -、-C(CH3)2 -、フルオレニル基から選ばれる少なくとも1種の基を示す。] かかる一般式(23)で表される化合物の具体例としては、例えば、以下の式(26)~(37)の化合物を挙げることができる。

【0090】式(26)

【化32】

式 (27)

【化33】

式 (28)

【化34】

一般式 (29)

【化35】

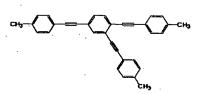
式 (30)

【化36】

40

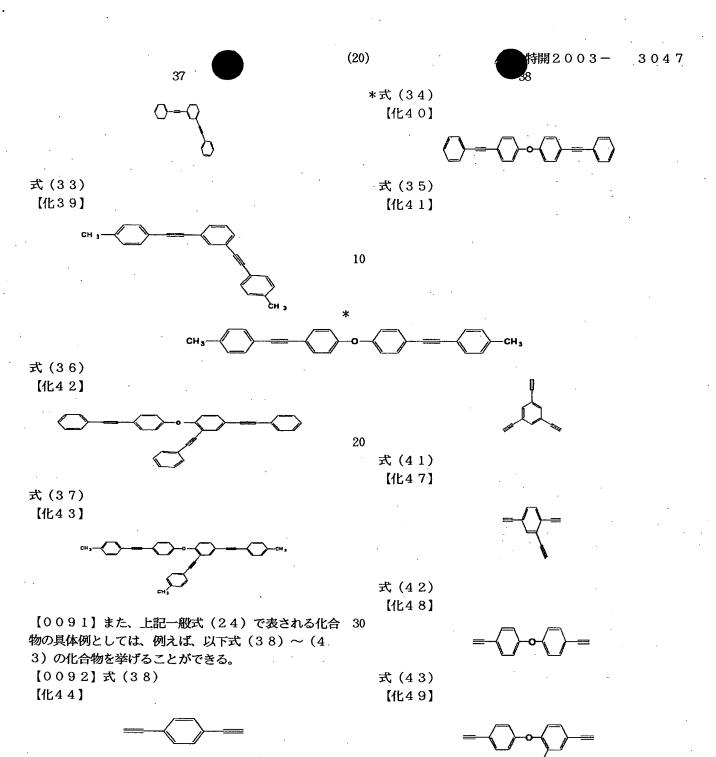
30

式(31) 【化37】



式(32)

50 【化38】



式 (39) 【化45】

式 (40) 【化46】 40 【0093】重合性の三重結合を含有する化合物としては、そのほか、エチニルベンゼン、ビス(トリメチルシリルエチニル)ベンゼン、トリス(トリメチルシリルエチニル)ベンゼン、トリス(トリメチルシリルエチニル)ベンゼン、ビス(トリメチルシリルエチニルフェニル)エーテル、トリメチルシリルエチニルベンゼンなどを挙げることができる。これらの重合性の三重結合を含有する化合物は、1種または2種以上を同時に使用しても良い。

【0094】このようにして得られる本発明の組成物の 50 全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり、

使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃 度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲 となり、保存安定性もより優れるものである。なお、こ の全固形分濃度の調整は、必要であれば、濃縮および上 記(B) 有機溶剤による希釈によって行われる。本発明 の組成物を、シリコンウエハ、SiO2ウエハ、SiN ウエハなどの基材に塗布する際には、スピンコート、浸 漬法、ロールコート法、スプレー法などの塗装手段が用 いられる。

【0095】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗 10 りで厚さ0. 05~2. 5 μ m程度、2回塗りでは厚さ 0. 1~5. 0 μ m程度の塗膜を形成することができ る。その後、常温で乾燥するか、あるいは80~600 ℃程度の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥 することにより、ガラス質または巨大高分子の絶縁膜を 形成することができる。この際の加熱方法としては、ホ ットプレート、オーブン、ファーネスなどを使用するこ とが出来、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、 アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした 減圧下などで行うことができる。また、電子線や紫外線 20 を照射することによっても塗膜を形成させることができ る。また、上記塗膜の硬化速度を制御するため、必要に 応じて、段階的に加熱したり、窒素、空気、酸素、減圧 などの雰囲気を選択することができる。さらに、本発明 のシリカ系膜の比誘電率は、通常、2.5~1.2、好 ましくは2.5~1.8である。

【0096】このようにして得られる層間絶縁膜は、 2. 5以下の比誘電率を示し、かつ塗膜弾性率、低吸湿 性及び耐クラック性に優れることから、LSI、システ ALSI, DRAM, SDRAM, RDRAM, D-R 30 DRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜やエッチングス トッパー膜、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、 多層レジストを用いた半導体作製工程の中間層、多層配 線基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁 膜、エレクトロルミネッセンス表示素子用の保護膜や絶 縁膜などの用途に有用である。。

[0097]

【実施例】以下、実施例を挙げて、本発明をさらに具体 的に説明する。なお、実施例および比較例中の部および %は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%で 40 あることを示している。また、実施例中における膜形成 用組成物の評価は、次のようにして測定したものであ

【0098】<u>重量</u>平均分子量(Mw)

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィ - (GPC) 法により測定した。

試料:テトラヒドロフランを溶媒として使用し、試料1 gを、100ccのテトラヒドロフランに溶解して調製 した。

標準ポリスチレン:米国プレッシャーケミカル社製の標 50 ; 傷からのクラックの伝播が認められない。

準ポリスチレンを使用した。

装置:米国ウオーターズ社製の高温高速ゲル浸透クロマ トグラム (モデル150-C ALC/GPC)

カラム:昭和電工(株)製のSHODEX A-80M

(長さ50cm) 測定温度:40℃

流速:1 c c/分

【0099】塗膜の比誘電率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で2分 間、窒素雰囲気200℃で2分間基板を乾燥し、さらに 400℃の窒素雰囲気のホットプレートで35分間基板 を焼成した。得られた基板に蒸着法によりアルミニウム 電極パターンを形成させ比誘電率測定用サンプルを作成 した。該サンプルを周波数100kHzの周波数で、横 河・ヒューレットパッカード (株) 製、HP16451 B電極およびHP4284AプレシジョンLCRメータ を用いてCV法により当該塗膜の比誘電率を測定した。 【0100】塗膜の弾性率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で2分 間、窒素雰囲気200℃で2分間基板を乾燥し、さらに 400℃の窒素雰囲気のホットプレートで35分間基板 を焼成した。得られた塗膜の弾性率は、ナノインデンタ **-XP**(ナノインスツルメント社製)を用いて、連続剛 性測定法により測定した。

【0101】塗膜の吸湿率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で2分 間、窒素雰囲気200℃で2分間基板を乾燥し、さらに 400℃の窒素雰囲気のホットプレートで35分間基板 を焼成した。この基板を温度23℃、湿度45%のクリ ーンルームの1ヶ月保存し、保存前後の塗膜形成基板を 電子科学(株)製昇温打つりガス分析装置EMD-WA 1000Sを用いて450℃まで加熱し脱離した水分量 を測定し、下記基準で評価した。

〇: (保存後の脱離水分量) / (保存前の脱離水分量) ≦1. 5

×; (保存後の脱離水分量) / (保存前の脱離水分量) >1.5

【0102】塗膜のクラック耐性

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で2分 間、窒素雰囲気200℃で2分間基板を乾燥し、さらに 400℃の窒素雰囲気のホットプレートで35分間基板 を焼成した。この際焼成後の塗膜の膜厚は5μmに調整 した。この塗膜にナイフで傷を付け、60℃のイオン交 換水に48時間浸漬した後、傷表面を顕微鏡で観察し、 以下の基準で評価した。

×:傷からのクラックの伝播が認められる。 【0103】合成例1

三つ口フラスコに、ヨウ化ナトリウム7.5g、無水塩 化二ッケル1.3g、トリフェニルホスフィン15.7 g、酢酸により活性化させた亜鉛粉末19.6g、およ び9,9-ビス(メチルスルフォニロキシ)フルオレン 16.7gを加え、24時間、真空下で乾燥したのち、 三つ口フラスコ内をアルゴンガスで充填した。次いで、 乾燥N,N-ジメチルアセトアミド50ml、乾燥テト ラヒドロフラン50ml、および2,4-ジクロロトル 10 エン10.8gを添加し、70℃アルゴン気流下で攪拌 したところ、反応液が褐色となった。そのまま、70℃ で20時間反応させたのち、反応液を36%塩酸400 mlおよびメタノール1,600ml混合液中に注ぎ、 沈殿物を回収した。得られた沈殿物を、クロロホルム中 に加えて懸濁させ、2規定塩酸水溶液で抽出を行ったの ち、クロロホルム層をメタノールに注ぎ、沈殿物を回 収、乾燥したところ、重量平均分子量10,300の白 色粉末状の重合体のを得た。

【0104】合成例2

窒素導入管、ディーンスターク、冷却管を取り付けた1 Lの三口フラスコに、9,9-ビス(4-ヒドロキシフ エニル) フルオレン26. 48g、9, 9-ビス (4-ヒドロー3-メチルキシフェニル) フルオレン28.3 5g、無水炭酸カリウム45.60g、ジメチルアセト アミド500mL、トルエン150mLをくわえ、窒素 雰囲気下140℃で3時間加熱を行った。塩形成時に生 成する水および過剰のトルエンを除去した後、反応溶液 を室温まで冷却した。その後この反応液に4,4 '-ジ フルオロベンゾフェノン32.73gを添加し、165 ℃で10時間反応させた。冷却後、反応液を10%HC 1含有メタノール5 Lに投じ再沈殿を行った。この沈殿 物を濾過、イオン交換水で十分に洗浄した後、真空オー ブンにて予備乾燥した。テトラヒドロフランにこの沈殿 物を再溶解させ、不溶部を除去した後、メタノールに再 沈殿させた。この再沈殿操作をもう一度繰り返すことに よりポリマーを精製し、乾燥は真空オーブン中80℃で 12時間行った。重量平均分子量150,000のの白 色粉末状の重合体②を得た。

【0105】合成例3

温度計、アルゴンガス導入管、攪拌装置を備えた1000m1三口フラスコにテトラヒドロフラン120m1、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム3.46g、ジクロロビストリフェニルホスフィンパラジウム

2. 1g、ヨウ化銅1. 44g)、ピペリジン20m 1、4,4'ービス(2ーヨードフェノキシ)ベンゾフェノン185.72gを加えた。次に、4,4'ージエチニルジフェニルエーテル65.48gを加え25℃で20時間反応させた。この反応液を酢酸5リットルで再沈殿を2回繰り返した後、シクロヘキサノンに溶かし超純水で2回洗浄し、メタノール5リットルで再沈殿し、沈殿を濾過、乾燥して重量平均分子量35,000の重合体③を得た。

0 【0106】比較合成例1

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン77.04gとテトラメトキシシラン24.05gとテトラキス(アセチルアセトナート)チタン0.48gを、プロピレングリコールモノプロピルエーテル290gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を60℃に安定させた。次に、イオン交換水84gを1時間かけて溶液に添加した。その後、60℃で2時間反応させたのち、アセチルアセトン25gを添加し、さらに30分間反応させ、反応液を室温まで冷却した。50℃で反応液からメタノールと水を含む溶液を149gエバポレーションで除去し、反応液①を得た。このようにして得られた加水分解縮合物(加水分解物およびその縮合物もしくはいずれか一方)の重量平均分子量は、8,900であった。

【0107】実施例1

合成例1で得られた重合体①2gとフラーレンC60 0.2gとシクロヘキサノン18gをホモジナイザーを 用いて十分攪拌した。この溶液を0.2μm孔径のテフ ロン(登録商標) 製フィルターでろ過を行い本発明の膜 形成用組成物を得た。得られた組成物をスピンコート法 でシリコンウエハ上に塗布した。塗膜の比誘電率は2. 43であり、塗膜の弾性率は6.4GPaと機械的強度 に優れていた。また、塗膜をクリーンルームに1ヶ月放 置した前後での脱離した水分量は1.15と低吸水性を 示した。また、温水浸漬後もクラックの伝播は認められ なかった。

【0108】実施例2~8

実施例1において、重合体の、フラーレンC60、シクロヘキサノンの代わりに表1に示す反応液を使用した以外は実施例1と同様に評価を行った。評価結果を表1に併せて示す。

[0109]

【表1】

爽	(A)	(B) 成分	(C)成分	塗膜比誘	金膜弾	途膜	逾膜 クラ
施	成分		·	電率	性 率	吸湿率	ック耐性
例					(GPa)		
ı	重合体①	シクロヘキサノン	フラーレン C60	2.43	6.4	0 .	0
	2g	18g	0.2g				
2	重合体①	ν-ブ [*] ƒロラタトン	フラーレン C70	2.49	5.8	0	0
	2g	18g	0.1g				
3	金合体②	シクロヘ・ンタノン	多層カーポンナノチ	2.87	6.3	0	0
	2g	18g	ı−7° 0.4g				
4	重合体②	<i>シチレン</i> 18g	単層カーキ゚ンナノチ	2.40	5.7	0	0
	2g_		1−7* 0.3g				
5	重合体③	シクロヘキサノン	多層カーポンナノサ	2.39	5.4	0	0
	2g	18g	ı−7° 0.2g				
6	重合体③	シクロヘキサノン	フラーレン C76	2.40	5.5	0	0
	2g	18g	0.2g				
7	重合体③	シクロヘキサノン	フラーレン C76	2.42	5.6	0	0
	2g	18g	0.2g				
8	重合体③	シグロヘキサノン	フラーレン C82	2.41	5.4	0	0
	2g	18g	0.1g		•		
			単届カーポンナノチ				
						!	İ

【0110】比較例1

合成例1で得られた重合体①2gとシクロヘキサノン18gのみを使用した以外は実施例1と同様にして塗膜の評価を行った。塗膜の比誘電率は2.88と2.5を越える比誘電率を示した。また、塗膜の弾性率も4.2と実施例に比べて劣る機械的強度を示した。

【0111】比較例2

比較合成例1で得られた反応液①にフラーレンC60 4gを添加したこと以外は実施例1と同様にして塗膜の評価を行った。塗膜の比誘電率は2.48と低い比誘電率を示し、塗膜の弾性率も6.2GPaと高い値であったが、塗膜をクリーンルームに1ヶ月放置した前後での*

*脱離した水分量は2.8と吸水性に劣るものであった。 また、塗膜を温水浸漬したところクラックの伝播が認め 30 られた。

[0112]

【発明の効果】本発明によれば、(A) 芳香族ポリアリーレンおよび芳香族ポリアリーレンエーテルもしくはいずれか一方、(B) 有機溶剤並びに(C) フラーレンおよびカーボンナノチューブもしくはいずれか一方を含有する含有することを特徴とする膜形成用組成物溶液を使用することで、2. 5以下の比誘電率を示し、かつ塗膜弾性率、低吸湿性及び耐クラック性に優れる半導体用塗膜(層間絶縁膜用材料)を提供することが可能である。

フロントページの続き

(51) Int.C1.7

識別記号

FΙ

テーマコート (参考)

HO1L 21/312

HO1L 21/312

Α

(72)発明者 山田 欣司

東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ スアール株式会社内

